

可提供评估板

MAXIM

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

MAX9850

概述

MAX9850 是低功耗高性能的立体声音频 DAC，同时还集成了 DirectDrive™ 耳机放大器。MAX9850 专为便携式设备设计，能够满足产品对电路板空间和性能的要求，适用于蜂窝电话、MP3 和便携式 DVD 播放器。

MAX9850 使用 Maxim 的 DirectDrive 耳机专利技术，从单电源产生以地为参考的模拟音频输出，允许放大器输出直接驱动耳机，不需大容量隔直电容。大大节省了电路板空间，可提供更高的咔哒/噼噗声抑制，并改善低频（低音）响应。这种结构不需要耳机插孔上有 DC 电压偏置，因此可以使用传统的机壳接地设计。

MAX9850 灵活的时钟电路可以使用任何现有的、最高至 40MHz 的系统时钟，无需外部 PLL 和多个晶振。无论在主机还是从机模式下，DAC 都能支持 8kHz 至 48kHz 宽范围的采样率，这些特性使 MAX9850 成为最容易使用、最通用的音频 DAC。该器件还可以作为传统的同步 DAC 使用，工作在任意整倍率过采样下。

音频 DAC 通过灵活的 3 线接口接收输入数据，支持左对齐、右对齐或 I²S 兼容的音频数据。另外还提供了立体声线路输入，可用于混合模拟音频与数字音频，或直接驱动耳机输出。通过 2 线 I²C 兼容接口进行模式设置、耳机放大器音量控制、设置耳机和输出关断模式。

MAX9850 额定工作在 -40°C 至 +85°C 扩展级温度范围，采用小外形、28 引脚、薄型 QFN 封装(5mm x 5mm x 0.8mm)。

应用

MP3/便携多媒体播放器
蜂窝电话/智能电话
便携 DVD 播放器

特性

- ◆ 1.8V 至 3.6V 单电源供电
- ◆ 1.8V 供电时可提供 30mW 立体声耳机输出功率
- ◆ DirectDrive 输出省去了隔直电容
- ◆ 1kHz 下具有 91dB PSRR
- ◆ 允许最高至 40MHz 的任意主时钟
- ◆ 灵活的 I²S 兼容数字音频接口
- ◆ I²C 耳机音量与静音控制
- ◆ 立体声线路输入与输出
- ◆ 无咔哒/噼噗声工作
- ◆ 2 线(I²C)兼容的控制接口
- ◆ 采用 28 引脚薄型 QFN 封装

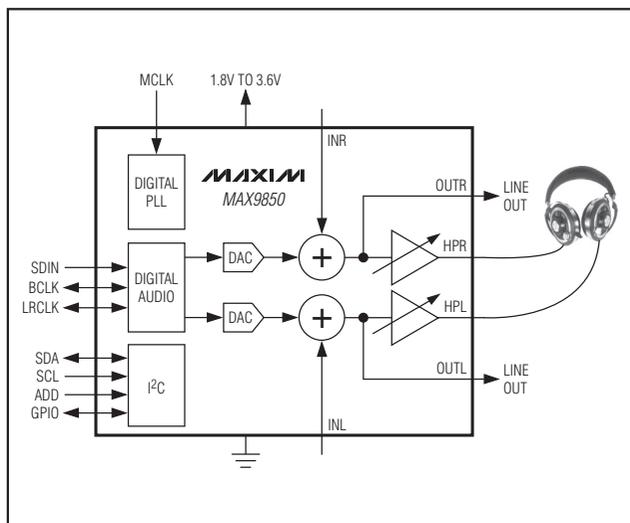
订购信息

PART	TEMP RANGE	PIN-PACKAGE	PKG CODE
MAX9850ETI+	-40°C to +85°C	28 TQFN-EP**	T2855-6

**EP = 裸焊盘。
+ 表示无铅封装。

引脚配置在数据资料的最后给出。

功能框图



立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

MAX9850

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Voltages with respect to AGND.)		
DV _{DD} , AV _{DD} , PV _{DD}	-0.3V to +4V	OUTL, OUTF
AV _{DD} Referenced to PV _{DD}	-0.3V to +0.3V	C1N
SV _{SS} , PV _{SS}	-4V to +0.3V	C1P
SV _{SS} Referenced to PV _{SS}	-0.3V to +0.3V	Current Into/Out of Any Pin
DGND, PGND	-0.3V to +0.3V	Duration of HPL, HPR, OUTL, OUTR Short Circuit to AGND
BCLK, LRCLK, HPS, SDIN	-0.3V to (DV _{DD} + 0.3V)	Continuous
GPIO, MCLK	-0.3V to +4V	Continuous Power Dissipation (T _A = +70°C)
REF, PREG	-0.3V to (AV _{DD} + 0.3V)	28-Pin Thin QFN (derate 35.7mW/°C above +70°C)
NREG	+0.3V to (SV _{SS} - 0.3V)	Junction Temperature
SDA, SCL, ADD	-0.3V to +4V	Operating Temperature Range
INL, INR	-2V to +2V	Storage Temperature Range
HPR, HPL	(SV _{SS} - 0.3V) to (AV _{DD} + 0.3V)	Lead Temperature (soldering, 10s)

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(DV_{DD} = AV_{DD} = PV_{DD} = 3.0V, AGND = DGND = PGND = 0V, C1 = 0.47μF, C2 = 2.2μF, C_{NREG} = C_{PREG} = C_{REF} = 1μF to AGND, R_{LOAD_HP} = 32Ω to AGND, R_{LOAD_OUT} = 10kΩ to AGND, f_{LRCLK} = 48kHz, f_{MCLK} = 12.288MHz, volume set to -9.5dB, T_A = T_{MIN} to T_{MAX}, unless otherwise noted. Typical specifications at T_A = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Analog Supply Voltage	AV _{DD} , PV _{DD}	AV _{DD} = PV _{DD}	1.8		3.6	V
Digital Supply Voltage	DV _{DD}		1.8		3.6	V
Analog Supply Current	AI _{DD}	Full operation (Note 2), no headphone or line output load	AV _{DD} = 1.8V	5.5	7.7	mA
			AV _{DD} = 3.0V	5.9		
		Full operation (Note 2), headphones disabled	AV _{DD} = 1.8V	3.5	5.3	
			AV _{DD} = 3.0V	3.75		
Digital Supply Current	DI _{DD}	Full operation (Note 2), no line output load	DV _{DD} = 1.8V	2.1	2.9	mA
		DV _{DD} = 3.0V	3.8			
Analog Shutdown Current	AI _{SHDN}	I _{AVDD} + I _{PVDD} , AV _{DD} = PV _{DD} = 1.8V		1.5	10	μA
Digital Shutdown Current	DI _{SHDN}	Static digital interface, DV _{DD} = 1.8V		0.3	5	μA
Shutdown to Full Operation (Note 2)	t _{ON}			1.3		ms
Power-On to Full Operation (Note 2)	t _{PON}			1.4		ms
DAC PERFORMANCE/LINE OUTPUTS (Note 3)						
0dBFS Output Voltage	V _{OUT_FS}		1.85	1.95	2.05	V _{P-P}
Dynamic Range (Note 4)	DR	AV _{DD} = 3.0V		87.5		dB
		AV _{DD} = 1.8V	82	87.5		
Signal-to-Noise Ratio (Note 5)	SNR	Unweighted		88		dB
		A-weighted		91		
		AV _{DD} = 1.8V, unweighted		88		
		AV _{DD} = 1.8V, A-weighted		91		

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

MAX9850

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

(DV_{DD} = AV_{DD} = PV_{DD} = 3.0V, AGND = DGND = PGND = 0V, C1 = 0.47μF, C2 = 2.2μF, C_{NREG} = C_{PREG} = C_{REF} = 1μF to AGND, R_{LOAD_HP} = 32Ω to AGND, R_{LOAD_OUT} = 10kΩ to AGND, f_{LRCLK} = 48kHz, f_{MCLK} = 12.288MHz, volume set to -9.5dB, T_A = T_{MIN} to T_{MAX}, unless otherwise noted. Typical specifications at T_A = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Total Harmonic Distortion Plus Noise	THD+N	f _{IN} = 984.375Hz	0dBFS	87		dB
			-60dBFS	27.5		
			AV _{DD} = 1.8V, 0dBFS	-81		
			AV _{DD} = 1.8V, -60dBFS	-27.5	-22	
Line Output Offset Voltage	V _{OS_LINE}		-15	0	+15	mV
Channel-to-Channel Gain Matching	ΔAV/AV	OUTL to OUTR, OUTR to OUTL		±0.04		dB
Power-Supply Rejection Ratio	PSRR	V _{RIPPLE} = 100mV _{P-P} , f _{IN} = 1kHz, applied to AV _{DD} and PV _{DD}		87		dB
		V _{RIPPLE} = 100mV _{P-P} , f _{IN} = 20kHz, applied to AV _{DD} and PV _{DD}		67		
Crosstalk	XTALK	f _{OUT} = 1kHz, V _{OUT} = 2V _{P-P} (OUTL to OUTR) or (OUTR to OUTL)		-105		dB
Sampling Frequency Range	f _S		8		48	kHz
MCLK Frequency	f _{MCLK}		8.448		40	MHz
DAC 8x INTERPOLATION FILTER						
Passband Frequency	PB	To -1dB corner	0		0.48 x f _S	kHz
Frequency Response	FR	10Hz to 20kHz	-0.1		+0.1	dB
Stopband Attenuation	SBA		58			dB
Stopband Frequency	SB	Attenuation greater than SBA	0.58 x f _S		7.42 x f _S	kHz
LINE INPUTS (INL, INR)						
Line Input Voltage	V _{IN_LINE}		-1		+1	V
IN_ to OUT_ Gain	A _{V_LINE}		-1.05	-1	-0.95	V/V
Line Input Bias Voltage	V _{BIAS_LINE}		-15	0	+15	mV
INL and INR Input Resistance	R _{IN_LINE}		10	22		kΩ
INTERNAL REGULATORS (NREG, PREG)						
PREG Output Voltage	V _{PREG}			1.60		V
NREG Output Voltage	V _{NREG}			-1.15		V
REF Output Voltage	V _{REF}			1.23		V

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

MAX9850

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

($V_{DD} = AV_{DD} = PV_{DD} = 3.0V$, $AGND = DGND = PGND = 0V$, $C1 = 0.47\mu F$, $C2 = 2.2\mu F$, $C_{NREG} = C_{PREG} = C_{REF} = 1\mu F$ to $AGND$, $R_{LOAD_HP} = 32\Omega$ to $AGND$, $R_{LOAD_OUT} = 10k\Omega$ to $AGND$, $f_{LRCLK} = 48kHz$, $f_{MCLK} = 12.288MHz$, volume set to $-9.5dB$, $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted. Typical specifications at $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
HEADPHONE OUTPUTS (HPL, HPR)						
Output Power	OUT	THD+N = 1% $f_{IN} = 1kHz$, headphone volume = +6dB	$R_L = 16\Omega$ $AV_{DD} = 3.0V$	95		mW
			$R_L = 32\Omega$ $AV_{DD} = 3.0V$	40	65	
			$R_L = 16\Omega$ $AV_{DD} = 1.8V$	30		
			$R_L = 32\Omega$ $AV_{DD} = 1.8V$	15	25	
Full-Scale Headphone Amplifier Output Voltage	V_{OUT_FS}	Volume = +5dB, HP unloaded	1.16	1.23	1.30	V_{RMS}
Line In to HP Output Voltage Gain	AV_{HP}	Volume = +3dB, HP unloaded	1.34	1.41	1.48	V/V
Total Harmonic Distortion Plus Noise	THD+N	$R_L = 32\Omega$, $P_{OUT} = 60mW$, $f_{IN} = 1kHz$	-94		dB	
		$R_L = 16\Omega$, $P_{OUT} = 60mW$, $f_{IN} = 1kHz$	-90			
Signal-to-Noise Ratio (Note 6)	SNR	Unweighted	88		dB	
		A-weighted	90			
		$AV_{DD} = 1.8V$, unweighted	88			
		$AV_{DD} = 1.8V$, A-weighted	91			
Power-Supply Rejection Ratio	PSRR	$V_{RIPPLE} = 100mV_{P-P}$, frequency = 1kHz, applied to AV_{DD} and PV_{DD}	91		dB	
		$V_{RIPPLE} = 100mV_{P-P}$, frequency = 20kHz, applied to AV_{DD} and PV_{DD}	72			
Headphone Output Offset Voltage	V_{OS_HP}	Volume = -11.5dB	$T_A = +25^\circ C$	-15	+15	mV
			$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}	-25	+25	
Slew Rate	SR		0.47		$V/\mu s$	
Maximum Capacitive Load	C_L	No sustained oscillations	150		pF	
Crosstalk	XTALK	$R_{HP} = 32\Omega$, $P_{OUT} = 3.5mW$, $f_{IN} = 1kHz$ (HPL to HPR) or (HPR to HPL)	-85		dB	
Channel-to-Channel Gain Matching	$\Delta A_V/A_V$		± 0.05		dB	
Internal Charge-Pump Oscillator Frequency	f_{CP}		550	667	775	kHz
Charge-Pump Operating Frequency Range		Charge-pump clock derived from MCLK	550	775		kHz
Volume Control Range			-73.5		+6.0	dB

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

MAX9850

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

(DV_{DD} = AV_{DD} = PV_{DD} = 3.0V, AGND = DGND = PGND = 0V, C1 = 0.47μF, C2 = 2.2μF, C_{NREG} = C_{PREG} = C_{REF} = 1μF to AGND, R_{LOAD_HP} = 32Ω to AGND, R_{LOAD_OUT} = 10kΩ to AGND, f_{LRCLK} = 48kHz, f_{MCLK} = 12.288MHz, volume set to -9.5dB, T_A = T_{MIN} to T_{MAX}, unless otherwise noted. Typical specifications at T_A = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Mute Attenuation				100		dB
DIGITAL INPUTS (GPIO, SCL, SDA, BCLK, LRCLK, SDIN, ADD, MCLK)						
Input High Voltage	V _{IH}		0.8 x DV _{DD}			V
Input Low Voltage	V _{IL}			0.2 x DV _{DD}		V
Input Leakage Current	I _{IH} , I _{IL}	V _{IH} = DV _{DD} , V _{IL} = DGND	-10		+10	μA
Input Hysteresis				0.09 x DV _{DD}		V
Input Capacitance	C _{IN}			10		pF
OPEN-DRAIN DIGITAL OUTPUTS (GPIO, SDA)						
Output-High Leakage Current	I _{OH}	V _{OH} = DV _{DD} (Note 7)			1	μA
Output Low Voltage	V _{OL}	I _{OL} = 3mA	DV _{DD} > 2V		0.4	V
			DV _{DD} < 2V		0.2 x DV _{DD}	
CMOS DIGITAL OUTPUTS (BCLK, LRCLK)						
Output High Voltage	V _{OH}	I _{OH} = 1mA	DV _{DD} - 0.4			V
Output Low Voltage	V _{OL}	I _{OL} = 1mA		0.4		V
HEADPHONE SENSE INPUT (HPS)						
Input High Voltage	V _{IH}		0.7 x DV _{DD}			V
Input Low Voltage	V _{IL}			0.25 x DV _{DD}		V
Input-High Leakage Current	I _{IH}	Full shutdown, V _{IH} = DV _{DD}		400		μA
		Normal operation, V _{IH} = DV _{DD}		1		
Input-Low Leakage Current	I _{IL}	Full shutdown, V _{IL} = DGND		1		μA
		Normal operation, V _{IL} = DGND		100		
Input Hysteresis				0.05 x DV _{DD}		V

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

MAX9850

TIMING CHARACTERISTICS

(DVDD = AVDD = PVDD = 3.0V, AGND = DGND = PGND = 0V, C1 = 0.47μF, C2 = 2.2μF, CNREG = CPREG = CREF = 1μF to AGND, RLOAD_HP = 32Ω to AGND, RLOAD_LINE = 10kΩ to AGND, fLRCLK = 48kHz, fMCLK = 12.288MHz, volume set to -9.5dB, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical specifications at TA = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I²C TIMING						
Serial Clock Frequency	fSCL		0		400	kHz
Bus Free Time Between STOP and START Conditions	tBUF		1.3			μs
Hold Time (Repeated) START Condition	tHD, STA		0.6			μs
SCL Pulse-Width Low	tLOW		1.3			μs
SCL Pulse-Width High	tHIGH		0.6			μs
Repeated START Condition Setup Time	tSU, STA		0.6			μs
Data Hold Time	tHD, DAT		0		900	ns
Data Setup Time	tSU, DAT		100			ns
Bus Capacitance	CB				400	pF
SDA and SCL Receiving Rise Time (Note 8)	tR		20 + 0.1CB		300	ns
SDA and SCL Receiving Fall Time (Note 8)	tF		20 + 0.1CB		300	ns
SDA Transmitting Fall Time (Note 8)	tF	DVDD = 1.8V, TA = +25°C	20 + 0.1CB		250	ns
		DVDD = 3.6V, TA = +25°C	20 + 0.05CB		250	
Setup Time for STOP Condition	tSU, STO		0.6			μs
Pulse Width of Suppressed Spike	tSP		0		50	ns
DIGITAL AUDIO TIMING						
BCLK Period (Note 9)	tBCLK		3 x 1 / fICLK			ns
Low or High BCLK Pulse Width	tBCLK_PW		0.35 x tBCLK			ns
BCLK and LRCLK Rise Time	tR	Master mode, CLOAD = 15pF		1		ns
BCLK and LRCLK Fall Time	tF	Master mode, CLOAD = 15pF		1		ns
SDIN or LRCLK to BCLK Rising Setup Time	tDBSU, tBWSU		30			ns
SDIN or LRCLK to BCLK Rising Hold Time	tDBH, tBWBH	DVDD = 1.8V			0	ns
		DVDD = 3.6V			5	

Note 1: The MAX9850 is 100% production tested at TA = +25°C and is guaranteed by design for TA = TMIN to TMAX.

Note 2: Full operation is defined as clocking all zeros into the DAC while the DAC, headphone outputs, and line outputs are all enabled.

Note 3: DAC performance specifications measured using the line outputs, OUTL and OUTR.

Note 4: Dynamic range is defined as the SNR of a 1kHz, -60dBFS input signal measured with an A-weighted filter, then normalized to full scale (+60dB).

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

MAX9850

Note 5: DAC SNR measured from DAC inputs to OUTL and OUTR.

Note 6: Headphone amplifier SNR measured from line inputs to headphone outputs.

Note 7: GPIO is 100kΩ to ground when DVDD < VOH < 3.6V.

Note 8: CB is in pF.

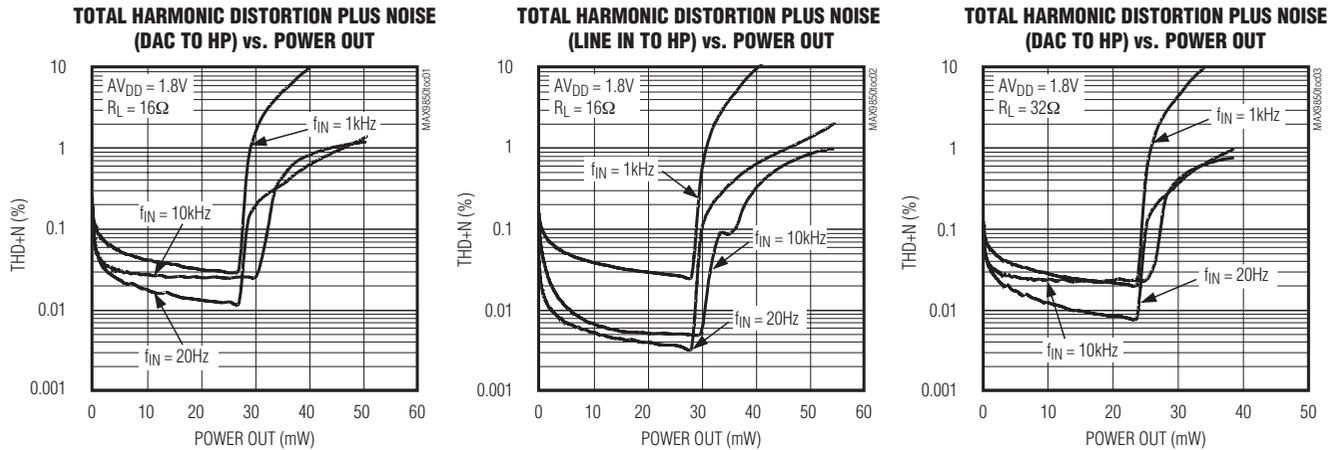
Note 9: f_{ICLK} derived by dividing f_{MCLK} by 1, 2, 3, or 4. See the *Registers and Bit Descriptions* section.

TYPICAL POWER DISSIPATION AT AVDD = 1.8V (No Headphone/Line Output Load)

MODE	AVDD POWER	DVDD POWER	PVDD POWER	TOTAL POWER
Full Operation (Note 1)	4.93mW	3.76mW	5.00mW	13.70mW
DAC to Line Outputs, Headphones Disabled	3.11mW	3.76mW	3.22mW	10.10mW
Line Inputs to Line Outputs and Headphone Outputs, DAC Disabled	3.22mW	0.085mW	3.40mW	6.71mW
Line Inputs to Line Outputs, DAC and Headphones Disabled	1.39mW	0.085mW	1.61mW	3.08mW
Full Shutdown	2.7μW	0.5μW	<0.1μW	3.2μW

典型工作特性

(DVDD = AVDD = PVDD = 3.0V, AGND = DGND = PGND = 0V, C1 = 0.47μF, C2 = 2.2μF, CNREG = CPREG = CREF = 1μF, f_S = 48kHz, f_{MCLK} = 12.288MHz, master integer mode, headphone volume set to +6dB, both channels driven in-phase, T_A = +25°C, unless otherwise noted. f_{IN} = 984.375Hz, A-weighted THD+N.)

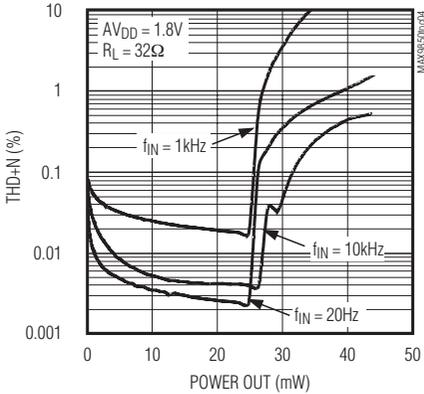


立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

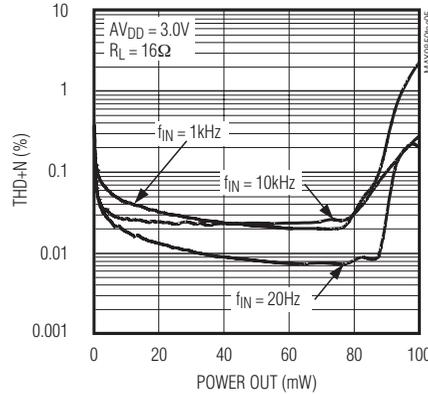
典型工作特性(续)

($V_{DD} = AV_{DD} = PV_{DD} = 3.0V$, $AGND = DGND = PGND = 0V$, $C1 = 0.47\mu F$, $C2 = 2.2\mu F$, $C_{NREG} = C_{PREG} = C_{REF} = 1\mu F$, $f_s = 48kHz$, $f_{MCLK} = 12.288MHz$, master integer mode, headphone volume set to +6dB, both channels driven in-phase, $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted. $f_{IN} = 984.375Hz$, A-weighted THD+N.)

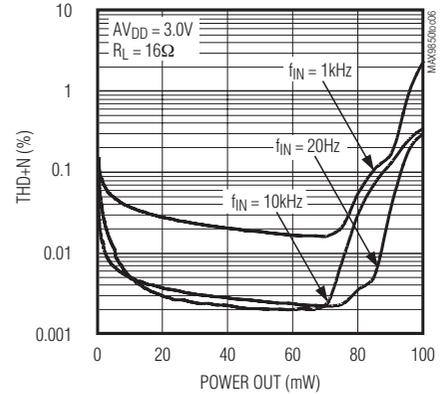
TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE (LINE IN TO HP) vs. POWER OUT



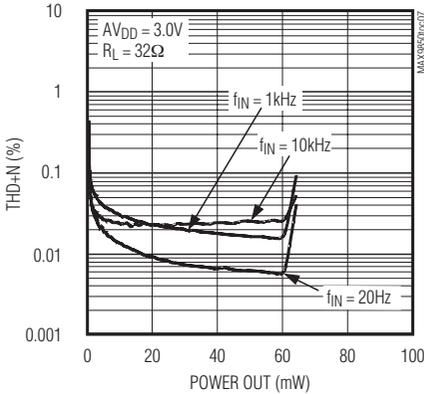
TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE (DAC TO HP) vs. POWER OUT



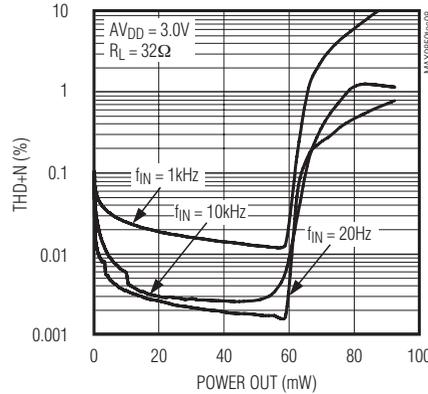
TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE (LINE IN TO HP) vs. POWER OUT



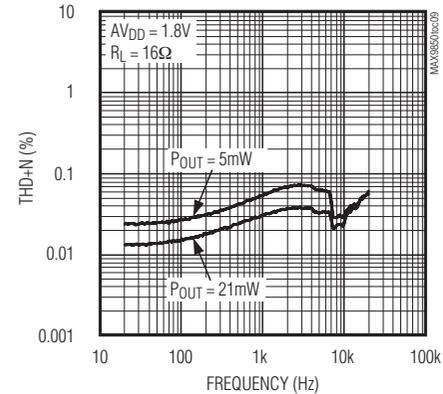
TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE (DAC TO HP) vs. POWER OUT



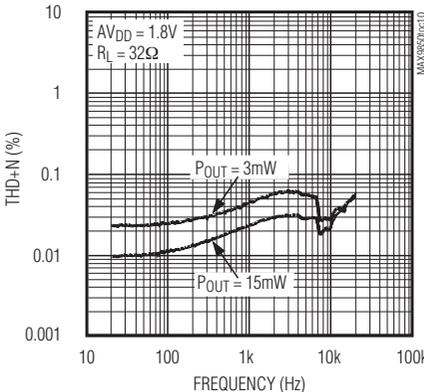
TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE (LINE IN TO HP) vs. POWER OUT



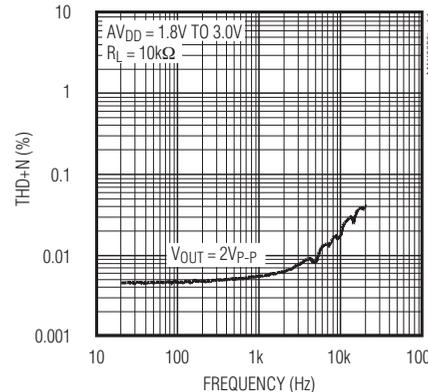
TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE (DAC TO HP) vs. FREQUENCY



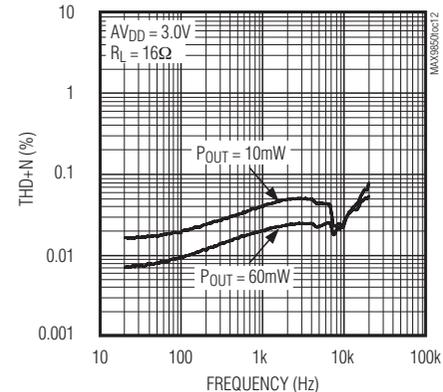
TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE (DAC TO HP) vs. FREQUENCY



TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE (DAC TO LINE OUT) vs. FREQUENCY



TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE (DAC TO HP) vs. FREQUENCY



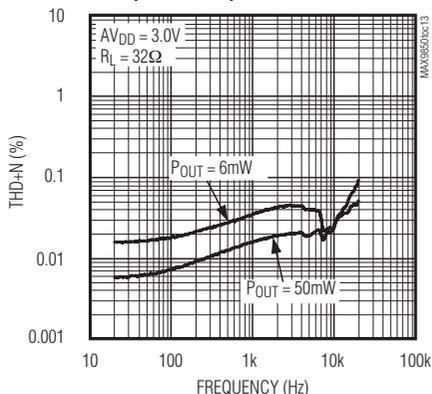
立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

典型工作特性(续)

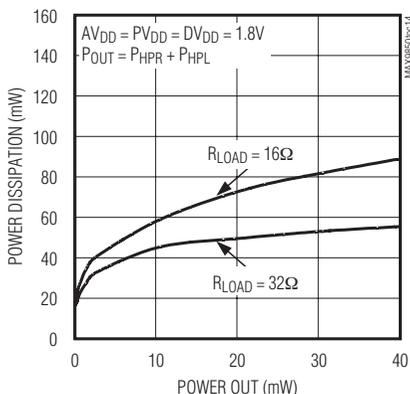
($DV_{DD} = AV_{DD} = PV_{DD} = 3.0V$, $AGND = DGND = PGND = 0V$, $C1 = 0.47\mu F$, $C2 = 2.2\mu F$, $C_{NREG} = C_{PREG} = C_{REF} = 1\mu F$, $f_s = 48kHz$, $f_{MCLK} = 12.288MHz$, master integer mode, headphone volume set to +6dB, both channels driven in-phase, $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted. $f_{IN} = 984.375Hz$, A-weighted THD+N.)

MAX9850

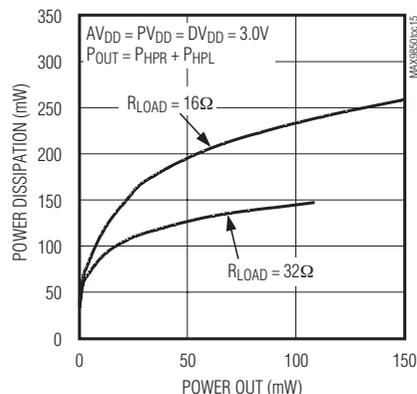
TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE (DAC TO HP) vs. FREQUENCY



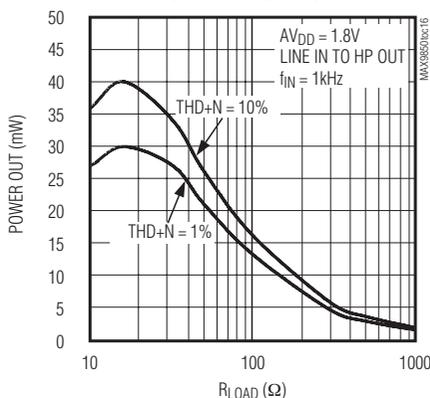
POWER DISSIPATION vs. POWER OUT



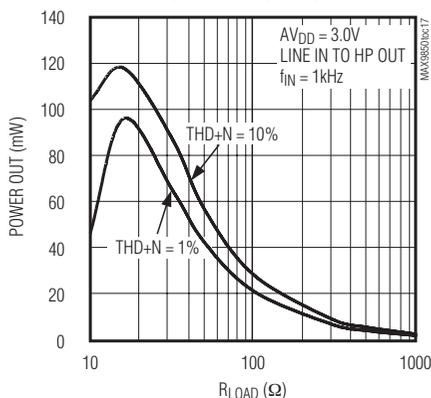
POWER DISSIPATION vs. POWER OUT



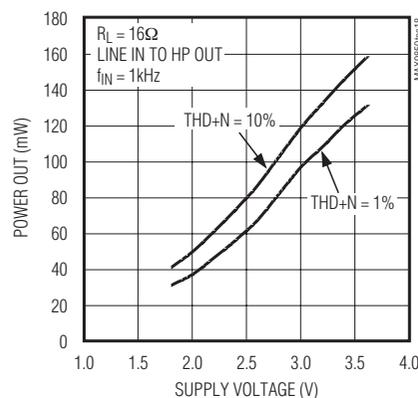
POWER OUT vs. HEADPHONE LOAD



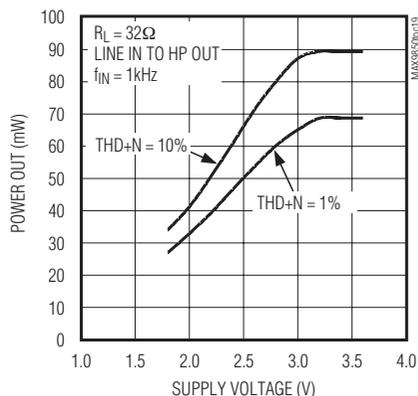
POWER OUT vs. HEADPHONE LOAD



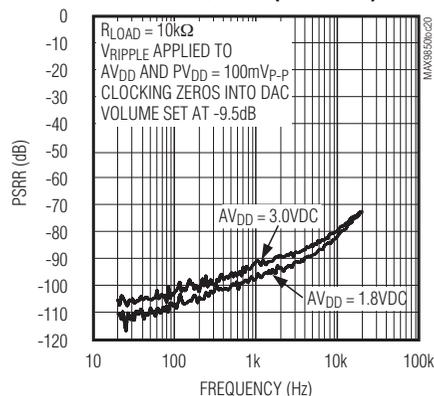
POWER OUT vs. SUPPLY VOLTAGE



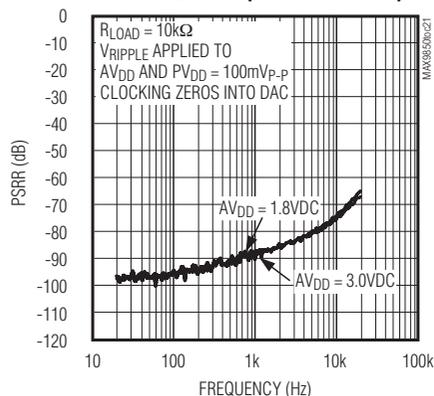
POWER OUT vs. SUPPLY VOLTAGE



POWER-SUPPLY REJECTION RATIO vs. FREQUENCY (DAC TO HP)



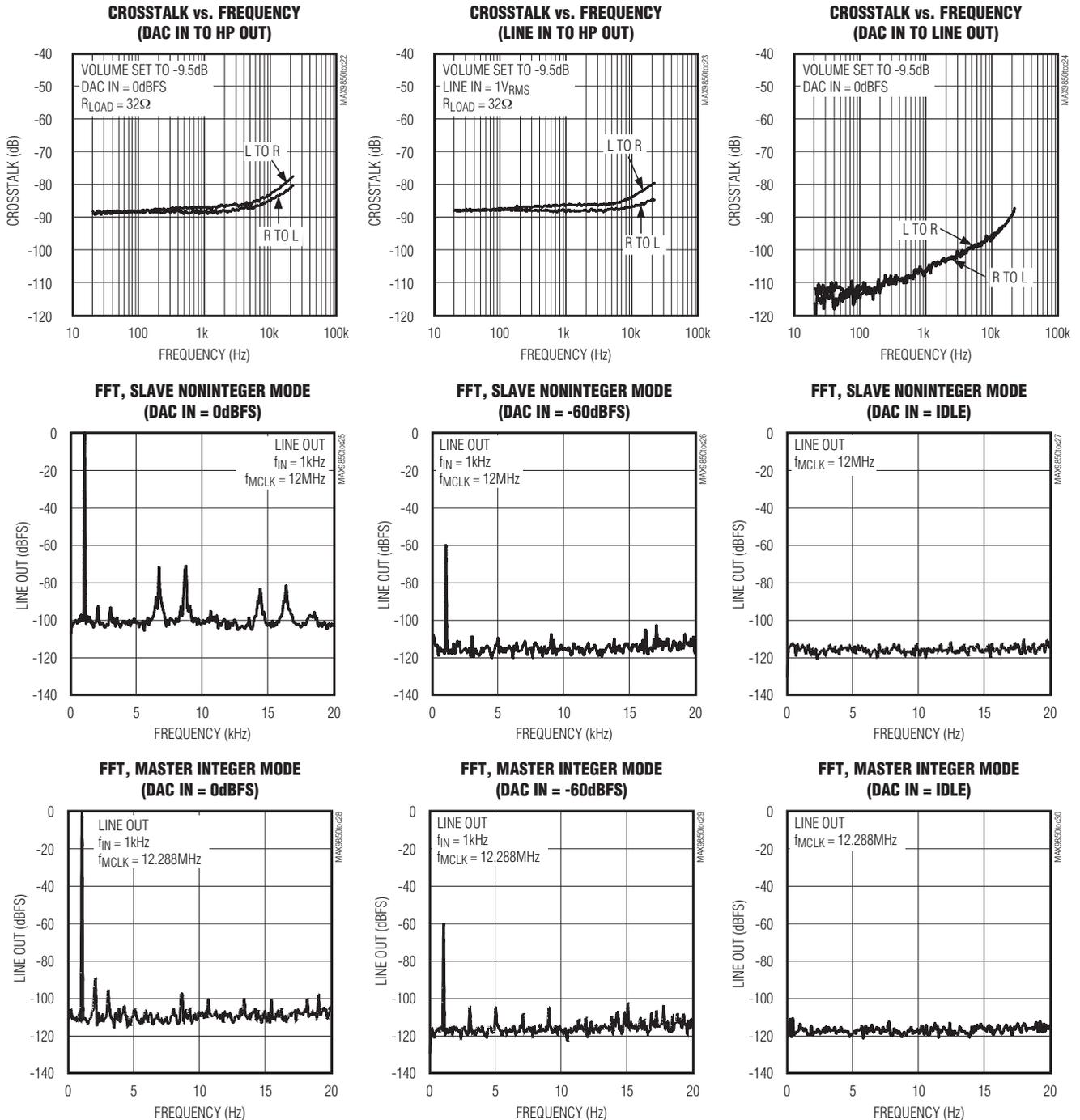
POWER-SUPPLY REJECTION RATIO vs. FREQUENCY (DAC TO LINE OUT)



立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

典型工作特性(续)

($V_{DD} = AV_{DD} = PV_{DD} = 3.0V$, $AGND = DGND = PGND = 0V$, $C1 = 0.47\mu F$, $C2 = 2.2\mu F$, $C_{NREG} = C_{PREG} = C_{REF} = 1\mu F$, $f_s = 48kHz$, $f_{MCLK} = 12.288MHz$, master integer mode, headphone volume set to +6dB, both channels driven in-phase, $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted. $f_{IN} = 984.375Hz$, A-weighted THD+N.)

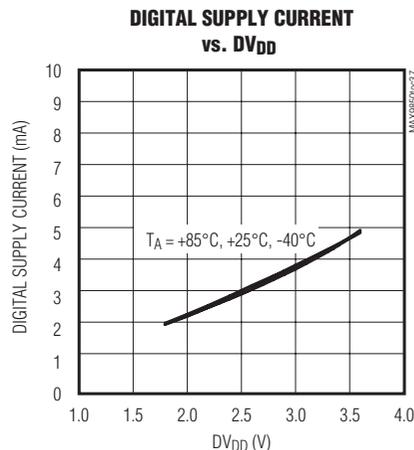
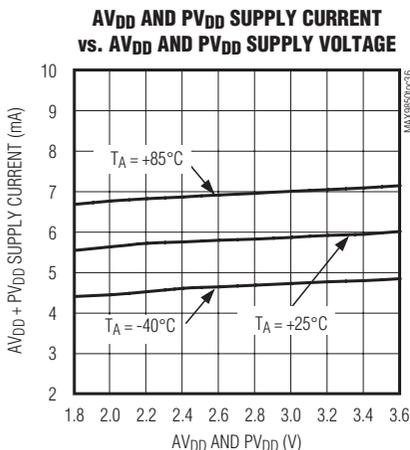
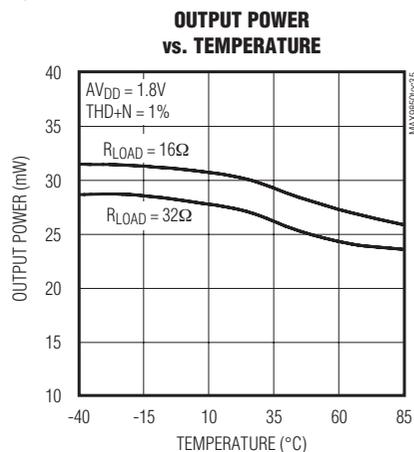
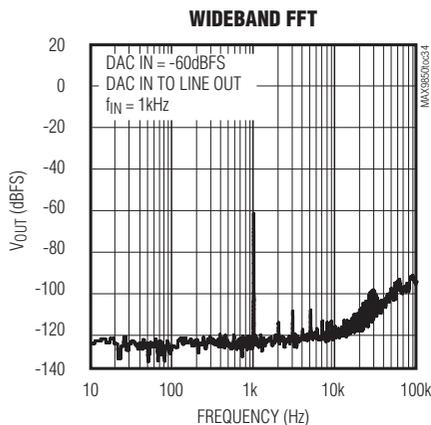
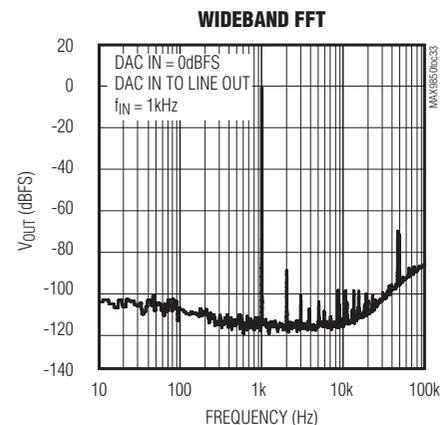
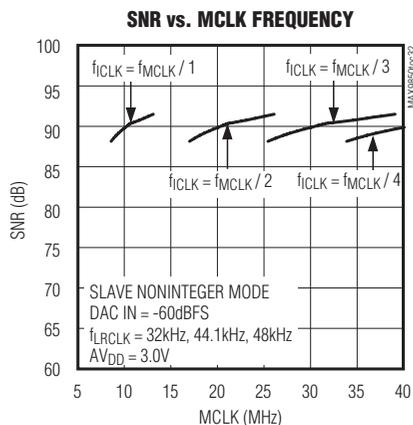
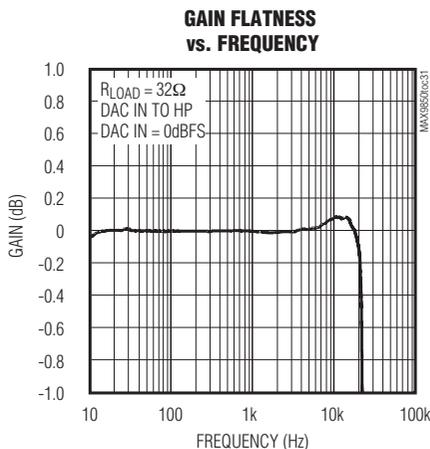


立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

典型工作特性(续)

($DV_{DD} = AV_{DD} = PV_{DD} = 3.0V$, $AGND = DGND = PGND = 0V$, $C1 = 0.47\mu F$, $C2 = 2.2\mu F$, $C_{NREG} = C_{PREG} = C_{REF} = 1\mu F$, $f_S = 48kHz$, $f_{MCLK} = 12.288MHz$, master integer mode, headphone volume set to +6dB, both channels driven in-phase, $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted. $f_{IN} = 984.375Hz$, A-weighted THD+N.)

MAX9850



立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

引脚说明

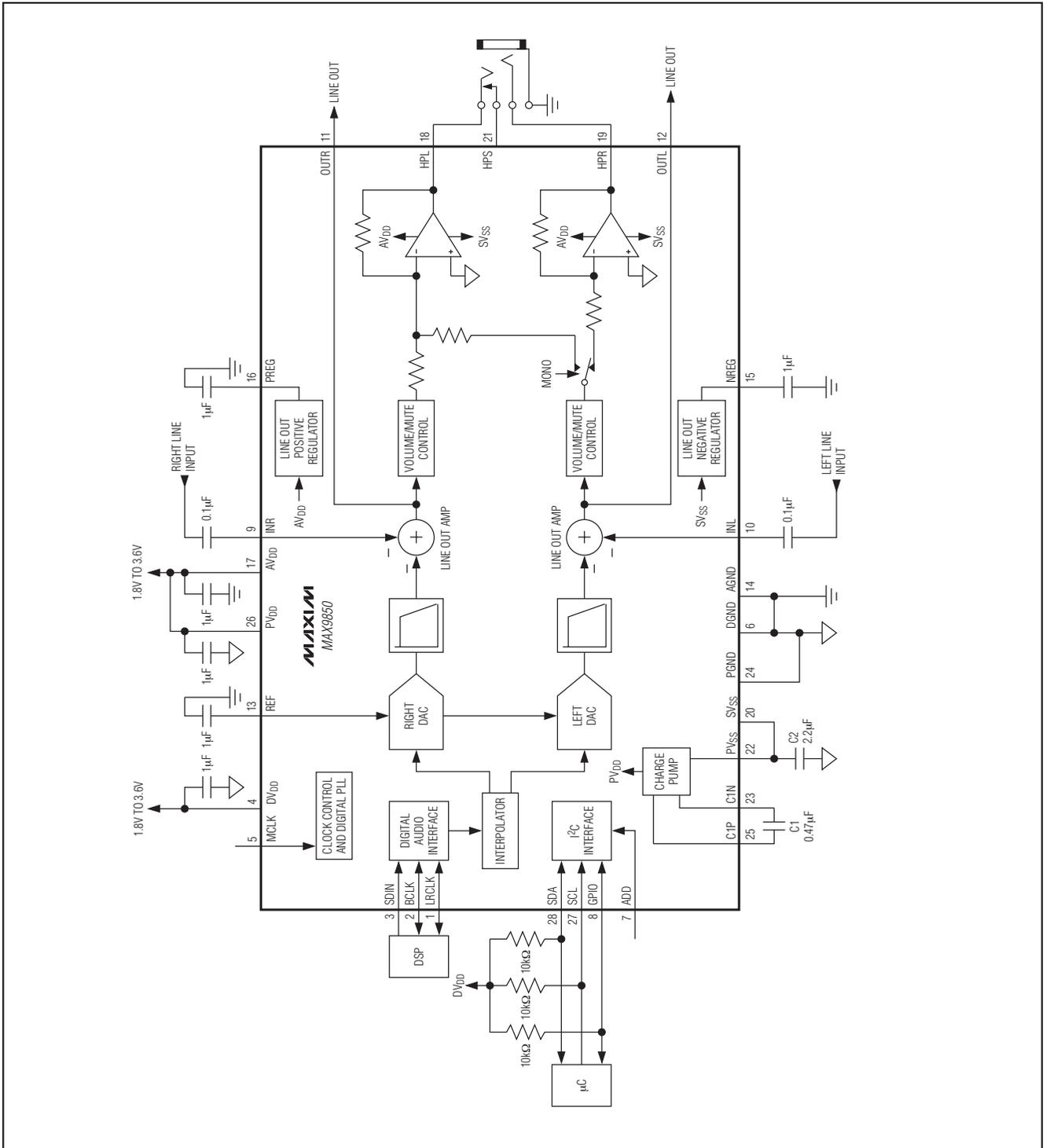
引脚	名称	功能
1	LRCLK	数字音频左-右声道选择时钟输入/输出。LRCLK 是音频采样率时钟，决定 SDIN 上的音频数据被送入左或右声道。当 MAX9850 工作在从模式时 LRCLK 为输入，主模式时为输出。
2	BCLK	数字音频比特时钟输入/输出。当 MAX9850 工作在从模式时 BCLK 为输入，主模式时为输出。
3	SDIN	数字音频串行数据输入。
4	DVDD	数字电源输入。用一个 1 μ F 陶瓷电容旁路到 DGND。
5	MCLK	主时钟输入。所有内部数字时钟均出自 MCLK。
6	DGND	数字地。
7	ADD	I ² C 地址选择输入。连接到 AGND、AV _{DD} 或 SDA 分别选择三种可能的 I ² C 地址之一。
8	GPIO	通用输入/输出。通过 GPIO 寄存器可配置 GPIO 为输入或输出。配置为输出时 GPIO 可执行中断功能。参见 GPIO 部分。
9	INR	右声道线路输入。INR 被混合到右声道 DAC 输出中。
10	INL	左声道线路输入。INL 被混合到左声道 DAC 输出中。
11	OUTR	右声道线输出。OUTR 被偏置于 AGND。
12	OUTL	左声道线输出。OUTL 被偏置于 AGND。
13	REF	基准输出。用一只 1 μ F 陶瓷电容旁路到 AGND。
14	AGND	模拟地。
15	NREG	线路输出级负稳压器输出。用一只 1 μ F 陶瓷电容旁路到 AGND。
16	PREG	线路输出级正稳压器输出。用一只 1 μ F 陶瓷电容旁路到 AGND。
17	AVDD	模拟电源。用一只 1 μ F 陶瓷电容旁路到 AGND。
18	HPR	右声道耳机输出。HPR 是偏置于 AGND 的 DirectDrive 输出。
19	HPL	左声道耳机输出。HPL 是偏置于 AGND 的 DirectDrive 输出。
20	SVSS	耳机放大器负电源输入。连接到 PVSS。
21	HPS	耳机检测输入。连接到耳机插孔的控制引脚用于耳机检测。如不使用可浮空 HPS。参见耳机检测输入 (HPS) 部分。
22	PVSS	反相电荷泵输出。用一只 2.2 μ F 陶瓷电容旁路到 PGND，接至 SVSS 来为耳机放大器提供负电源。
23	C1N	电荷泵浮动电容负端。C1N 和 C1P 之间接一只 0.47 μ F 的陶瓷电容。
24	PGND	电荷泵地。
25	C1P	电荷泵浮动电容正端。C1N 和 C1P 之间接一只 0.47 μ F 的陶瓷电容。
26	PVDD	电荷泵和耳机放大器正电源输入。用一只 1 μ F 陶瓷电容旁路到 PGND。正常工作时可接至 AVDD。
27	SCL	I ² C 兼容接口串行时钟输入。
28	SDA	I ² C 兼容接口串行数据输入/输出。
—	EP	裸露的散热片。连接 EP 至 AGND。

MAX9850

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

功能框图/典型工作电路

MAX9850



立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

详细说明

MAX9850 音频数模转换器(DAC), 具有立体声 DirectDrive 耳机放大器, 是完整的数字音频放大方案。Σ-Δ DAC 的动态范围为 90dB, 接受采样率范围在 8kHz 至 48kHz 的立体声音频数据。通过 I²C 兼容接口设置耳机输出音量、静音和器件配置。提供三个可选的 I²C 器件 ID。整型与非整型两种基本操作模式均可提供全动态范围, 为选择 MAX9850 主时钟(MCLK)频率提供了最大的灵活性。整型工作模式要求 MCLK 是 16 倍采样率的整数倍, 并提供最大的满度 SNR 性能。非整型模式给 MCLK 频率的选择提供了最大的灵活性, MCLK 可以是允许范围内的任意频率。

音频数据通过 3 线数字音频数据总线发送到 MAX9850, 该总线支持多种输入格式。在主机模式下, LRCLK 和 BCLK 信号由 MAX9850 产生。MAX9850 还可以配置为从机模式, 接收来自外部数字音频主机的 LRCLK 和 BCLK 信号。MAX9850 配置为从机时, 外部 LRCLK 和 BCLK 信号可以与 MCLK 同步或异步。

Maxim 的 DirectDrive 结构采用内部电荷泵产生负电源电压, 为耳机放大器输出级供电。内部负电源使输出信号可以被偏置到地, 省去了输出耦合电容, 降低了系统的成本与尺寸。

利用 MAX9850 的立体声线路输入可以将模拟音频与数字音频混合。混合后的音频信号直接送到线路输出与耳机输出。即使 DAC 被禁止和 MCLK 没有信号时, 线路输入/输出也能工作。

耳机检测输入(HPS)能检测到耳机与 MAX9850 的连接。没有耳机连接时, HPS 电路关断耳机放大器输出。HPS 检测到耳机连接时, 耳机放大器自动使能。

Σ-Δ DAC

MAX9850 使用 Σ-Δ DAC, 可提供高达 91dB 的 SNR。DAC 接收以 f_{LRCLK} 频率采样的立体声数字输入信号, 将信号数据内插处理为 8 倍 f_{LRCLK} 频率, 并对采样信号进行数字滤波。得到的过采样数字信号使用多位 Σ-Δ 调制器和

模拟平滑滤波器进行转换, 模拟平滑滤波器能显著衰减由过采样转换器产生的高频量化噪声。MAX9850 具有灵活的时钟模式, 在不需要昂贵的采样率转换器的情况下, 可以有效用于一般不太适合过采样转换器的应用中。

在使能寄存器中设置 DACEN = 0 (寄存器 0x5, B0 位), 禁止 DAC。设置 DACEN = 1 则使能 DAC。

线路输入/输出

MAX9850 具有线路输入(INR、INL)与线路输出(OUTR、OUTL)。利用线路输入可将一路线路级的信号与 DAC 输出混合, 参见功能框图/典型工作电路。在使能寄存器中设置 LNIEN = 1 (寄存器 0x5, B1 位)可使能线路输入。线路输入被偏置到 AGND, 可以根据信号源选择直接耦合或 AC 耦合到 INR 与 INL。

立体声 DirectDrive 线路输出(OUTR 与 OUTL)用来驱动线路负载。线路输出在内部还驱动耳机放大器的输入。在使能寄存器中设置 LNOEN = 1 (寄存器 0x5, B2 位), 使能线路输出。禁止线路输出的同时也将禁止耳机输出。

为了使用线路输出, 必须使能内部电荷泵。在使能寄存器中配置 CPEN(1:0) = 11 (寄存器 0x5, B5 和 B4 位)即使能电荷泵, 参见电荷泵部分。

DirectDrive 耳机与线路放大器

传统单电源耳机放大器与 MAX9850 不同, 为获得最大动态范围, 其输出偏置在某个直流电压, 通常是电源电压的一半。需要一个大耦合电容来隔离耳机与这个直流偏置。若没有这个电容, 将有显著的直流电流流入耳机, 造成不必要的功耗, 并可能损坏耳机与耳机放大器。

Maxim 的专利技术 DirectDrive 使用电荷泵来产生内部负电源电压。这就允许 MAX9850 的耳机与线路输出偏置到地, 其动态范围几乎是使用单电源供电时的两倍。由于没有直流成分, 也就不需要大的隔直电容。MAX9850 电荷泵只需要两个小陶瓷电容(0.47μF 和 2.2μF), 但去掉了

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

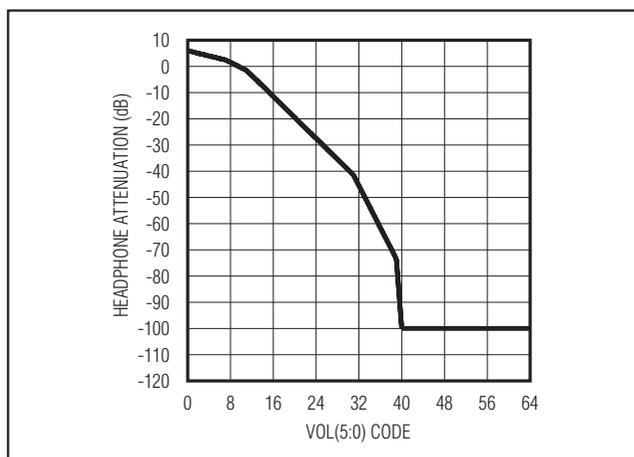


图1. 耳机放大器的衰减曲线

两个大容值(33 μ F至330 μ F)电容，从而节省电路板空间、降低成本、改善频率响应与耳机放大器的THD。传统耳机放大器所需的隔直电容除了成本与尺寸的缺点外，也限制了低频响应，并降低了PSRR性能。一些电介质可能使音频信号显著失真。

音量控制

通过编程音量寄存器中的VOL(5:0) (寄存器0x2, B5-B0位)可以控制耳机放大器的音量衰减量。VOL(5:0)编程为0x00时为最高音量。VOL(5:0)大于或等于0x28时音量最小。当MAX9850被编程为0x3F音量级时，状态A寄存器中的VMN(寄存器0x0, B3位)置1。图1给出了VOL(5:0)值与衰减量的关系曲线。

音量摆率控制、过零检测与静音

在音量寄存器中设置SLEW = 1(寄存器0x2, B6位)，使能音量摆率控制电路。SLEW = 1时，耳机放大器的音量将按照一定的摆率平滑变化。通过电荷泵寄存器中的SR(1:0) (寄存器0x7, B7与B6位)设置音量摆率。表1列出了每个SR(1:0)数值对应的音量摆率。

在通用寄存器中设置ZDEN = 1(寄存器0x3, B0位)，将强制内部电路只在音频信号过零时改变音量和进入静音模式。为了获得最佳性能，设置SR(1:0)为01。这种过零检测降低了在不同音量转换时所产生的咔哒声。

在音量寄存器中设置MUTE = 1(寄存器0x2, B7位)可使耳机放大器进入静音模式。静音功能与音量控制无关。

表1. 摆率设置

SR1	SR0	TYPICAL VOLUME SLEW RATE	
		FROM FULL VOLUME TO MUTE	FROM FULL VOLUME TO VMN = 1 (ms)
0	0	63 μ s	0.1
0	1	125ms	200
1	0	63ms	100
1	1	42ms	67

进入静音模式时，已设定的音量并不复位。如果过零检测与音量摆率控制使能，静音命令发出后的第一个过零点或经过200ms延时(SR = 01)后输出关闭。

单声道模式

在通用寄存器中设置MONO = 1(寄存器0x3, B2位)，使能单声道模式。单声道模式下，禁止HPR，左右声道叠加，并从HPL输出。叠加后的信号幅值有6dB衰减，以确保不会过驱动耳机放大器。MAX9850处于单声道模式时，状态B寄存器中的SMONO(寄存器0x1, B4位)置1。

配置耳机与线路输出

在使能寄存器中设置HPEN和LNOEN(寄存器0x5, B3和B2位)等于1，使能耳机输出(HPR和HPL)。设置HPEN或LNOEN = 0则禁止耳机输出。

耳机放大器输入由线路放大器输出驱动。在使能寄存器中设置LNOEN = 0(寄存器0x5, B2位)将禁止线路输出，同时也切断了耳机放大器的输入信号，因而也会关闭耳机输出(HPR和HPL)。

为了使耳机与线路输出工作，必须使能内部电荷泵。在使能寄存器中设置CPEN(1:0) = 11(寄存器0x5, B5和B4位)即使能电荷泵。更多细节见电荷泵部分。

耳机检测输入(HPS)

耳机检测输入(HPS)监视耳机插孔，并根据HPS上的电压自动禁止耳机放大器。为实现耳机检测，将HPS连接到3线耳机插孔的控制引脚，如图2所示。没有插入耳机时，耳机放大器的输出阻抗将HPS拉至低于0.3 x DV_{DD}。当耳机插入插孔时，控制引脚与顶端簧片断开，HPS通过内部100k Ω 上拉至DV_{DD}，不需要外部电阻。若不使用自

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

MAX9850

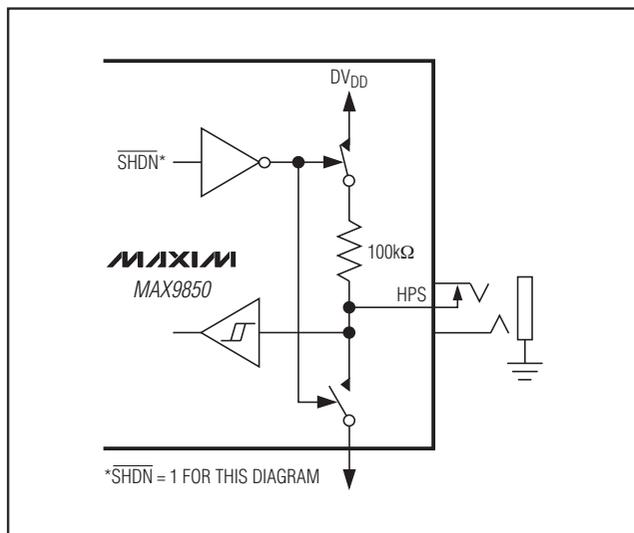


图2. 耳机检测(HPS)输入

动耳机检测，则使 HPS 悬空。为了使耳机放大器(HPR 和 HPL)输出音频信号，HPS 必须为高，且 HPEN (寄存器 0x5, B3 位)必须置 1。

MAX9850 中包含 HPS 去抖电路，可以忽略 HPS 上的瞬时变化。去抖电路可确保在耳机正确连接之后再给耳机放大器加电并使能。通过通用寄存器中的 DBDEL(1:0) (寄存器 0x3, B4 和 B3 位)可以设定 HPS 去抖延时时间。延迟时间由电荷泵频率 f_{CP} 分频得到。电荷泵频率设置的详细内容见电荷泵部分。表 2 列出了几种可能的去抖电路延迟时间。

使用自动耳机检测时，拨去耳机的状态检测没有延时。HPS 变高时，耳机放大器立刻进入关断。

状态 A 寄存器中的 SHPS (寄存器 0x0, B4 位)用来报告 HPS 的状态。HPS 为低时，SHPS = 0；HPS 为高时，SHPS = 1。

表2. HPS 去抖时间

DBDEL(0)	DBDEL(1)	DEBOUNCE TIME (ms)	DEBOUNCE TIME BASED ON $f_{CP} = 667\text{kHz}$ (ms)
0	0	0	0 (Disabled)
0	1	$2^{17} \times 1 / f_{CP}$	Approx 200
1	0	$2^{18} \times 1 / f_{CP}$	Approx 400
1	1	$2^{19} \times 1 / f_{CP}$	Approx 800

GPIO

通用寄存器中的 GPD 位(寄存器 0x3, B5 位)用来配置 GPIO 为输入或输出。GPD = 1 配置 GPIO 为开漏极输出，而 GPD = 0 配置 GPIO 为上拉电阻。配置 GPIO 为输出时，在 GPIO 与 DV_{DD} 之间连接外部上拉电阻。

GPIO 作输出时，MAX9850 可以驱动 LED 或其他状态指示器。还可以用来提供中断信号，在事件发生时通知 μC 。这些事件包括内部 PLL 锁定状态的变化、耳机连接到 HPS、耳机输出达到最小音量或耳机输出过流。配置 GPIO 为开漏极输出时，可以设置这些事件使 GPIO 输出脉冲状态。

GPIO 作输入时，MAX9850 可以从 μC 的数字 I/O 或其他器件接收信号。GPIO 的状态通过状态 A 寄存器的 SGPIO (寄存器 0x0, B6 位)读取。

GPIO 用作输出

设置 GPD = 1 (寄存器 0x3, B5 位)配置 GPIO 为输出。设置通用寄存器中的 GM(1:0) (寄存器 0x3, B7 和 B6)来设定 GPIO 的输出工作模式。GPIO 可以设置为输出逻辑高、逻辑低，或者当状态 A 寄存器中的 ALERT 位 (寄存器 0x0, B7 位)置位时，通过改变状态输出中断信号。表 3 给出了 GPIO 的工作模式。

表3. GPIO 输出工作模式(GPD = 1)

GM(1)	GM(0)	MODE DESCRIPTION
0	0	GPIO = 0
0	1	GPIO = High impedance
1	0	GPIO = 0, ALERT output pulse enabled
1	1	GPIO = High impedance, ALERT output pulse enabled

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

MAX9850

表 4. 中断使能寄存器(0x4)事件

EVENT	BIT NUMBER IN REGISTER 0x4
LCK (register 0x0, bit B5) sets when the internal PLL acquires or loses frequency lock	B5
SHPS (register 0x0, bit B4) sets after the headphone is inserted and the debounce time has elapsed when the headphone amplifier is powered up and ready	B4
VMN (register 0x0, bit B3) sets when the headphone amplifier minimum volume is reached	B3
IOHL or IOHR (register 0x0, bits B1 or B0) sets after an overcurrent at either HPL or HPR	B0

通过中断使能寄存器，可使 MAX9850 在有事件发生时设置 ALERT = 1。若 GM(1:0) 被设置为 10 或 11，则 ALERT 置位时，GPIO 输出脉冲。表 4 列出了使 ALERT 置位的事件，及其在中断使能寄存器中相应位的位置。将相应位置 1 使能该事件的中断。

GPIO 用作输入

GPIO 输入的状态通过状态 A 寄存器的 SGPIO (寄存器 0x0, B6 位) 读取。设置 ISGPIO = 1 时，当 SGPIO 改变状态时 ALERT 置位。

内部定时

内部时钟(ICLK)和采样率时钟(主机模式下的 LRCLK)从 MCLK 获得。MAX9850 灵活的工作模式在宽范围的 MCLK 输入频率下可以获得期望的 LRCLK 采样率。

图 3 所示的流程图详细说明了由 MCLK 得到内部时钟的过程。MAX9850 通过 MCLK 频率分频产生 ICLK。较高的 ICLK 频率可以得到更高的 DAC 过采样与 SNR 性能。当 f_{ICLK} 大于或等于 12MHz 时，可以实现 90dB (典型值) 的动态范围。较低的 ICLK 频率需要的电源电流可能稍小，但牺牲了动态范围。参见典型工作特性中的 SNR vs. MCLK Frequency 曲线图。

ICLK 和 MCLK 频率成比例关系，MAX9850 用它为内部 DAC 电路提供时钟，并在主机模式下产生 LRCLK 和 BCLK。不使用内部电荷泵振荡器时，电荷泵时钟也由 ICLK 获得。

采用一个现有的系统时钟连接到 MCLK，见 DAC 工作模式部分。MCLK 可以由频率落在 8.448MHz 至 13MHz 或 16.896MHz 至 40MHz 范围内的同步或异步系统时钟提供。该范围内的 MCLK 可使 MAX9850 以主机或从机模式工作在 8kHz 至 48kHz 的所有采样率下。也可以使用其他 MCLK 频率，但会限制 MAX9850 工作的采样率范围，详见表 5 说明。

较高的 ICLK 频率可提供更高的 SNR。尽可能使用最高的 ICLK。也可以使用表 5 之外的采样率。MAX9850 上电时默认 IC(1:0) = 0x0。

DAC 工作模式

有四种 DAC 工作模式：主机整型模式、从机整型模式、主机非整型模式和从机非整型模式，这些工作模式可使该器件灵活地工作在不同应用中，基本上可以利用任意的系统频率作为 MCLK。工作模式由数字音频寄存器中的 MAS (寄存器 0xA, B7 位) 以及 LRCLK MSB 寄存器中的 INT (寄存器 0x8, B7 位) 设定。表 6 给出了四种工作模式，以及 MAX9850 设置 DAC 模式所需的公式。

主机与从机整型模式就是普通的 DAC 工作模式。这些模式下，LRCLK 是 ICLK 的整数倍分频。典型应用设置 MCLK 等于 256 x LRCLK。MAX9850 要求 ICLK 是 16 x LRCLK 的整数倍，而在主机或从机整型模式下，倍数应至少是 10。与其他工作模式相比，整型模式总能提供最大的满量程信号电平性能。尽可能优先选用整型工作模式。

主机非整型模式可以用在 LRCLK 与 ICLK 没有整数倍关系的情况下。在这些模式下，MAX9850 可工作在任意系统现有的 MCLK 下。

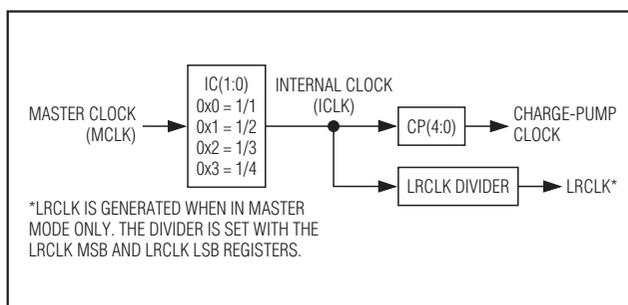


图 3. 内部时钟由 MCLK 产生

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

MAX9850

表 5. 可接受的 MCLK 频率范围

LRCLK (kHz)	MINIMUM ICLK (MHz)		MAXIMUM ICLK (MHz)	ACCEPTABLE MCLK FREQUENCIES* (MHz)			
	INTEGER MODE (160 x f _{LRCLK})	NONINTEGER MODE (176 x f _{LRCLK})		ANY MODE	IC(1:0) = 0x0 SF = 1	IC(1:0) = 0x1 SF = 2	IC(1:0) = 0x2 SF = 3
8	1.280	1.4080	13.0	1.280 and 1.4080 to 13.0	2.560 and 2.8160 to 26.0	3.840 and 4.2240 to 39.0	5.120 and 5.6320 to 40.0
11.025	1.764	1.9404	13.0	1.764 and 1.9404 to 13.0	3.528 and 3.8808 to 26.0	5.292 and 5.8212 to 39.0	7.056 and 7.7616 to 40.0
12	1.920	2.1120	13.0	1.920 and 2.1120 to 13.0	3.840 and 4.2240 to 26.0	5.760 and 6.3360 to 39.0	7.680 and 8.4480 to 40.0
16	2.560	2.8160	13.0	2.560 and 2.8160 to 13.0	5.120 and 5.6320 to 26.0	7.680 and 8.4480 to 39.0	10.240 and 11.2640 to 40.0
22.05	3.528	3.8808	13.0	3.528 and 3.8808 to 13.0	7.056 and 7.7616 to 26.0	10.584 and 11.6424 to 39.0	14.112 and 15.5232 to 40.0
24	3.840	4.2240	13.0	3.840 and 4.2240 to 13.0	7.680 and 8.4480 to 26.0	11.520 and 12.6720 to 39.0	15.360 and 16.8960 to 40.0
32	5.120	5.6320	13.0	5.120 and 5.6320 to 13.0	10.240 and 11.2640 to 26.0	15.360 and 16.8960 to 39.0	20.480 and 22.5280 to 40.0
44.1	7.056	7.7616	13.0	7.056 and 7.7616 to 13.0	14.112 and 15.5232 to 26.0	21.168 and 23.2848 to 39.0	28.224 and 31.0464 to 40.0
48	7.680	8.4480	13.0	7.680 and 8.4480 to 13.0	15.360 and 16.8960 to 26.0	23.040 and 25.3440 to 39.0	30.720 and 33.7920 to 40.0

* 列出的第一个频率是工作在整型模式下所需的最小 MCLK 频率。频率范围表示 MAX9850 工作在任意模式下所需的 MCLK 频率。

表 6. DAC 工作模式

MODE	SLAVE MODE (MAS = 0) <i>LRCLK and BCLK signals supplied from external source</i>	MASTER MODE (MAS = 1) <i>LRCLK and BCLK signals supplied by MAX9850</i>
NONINTEGER MODE (INT = 0) <i>LRCLK may be any frequency within an acceptable range</i>	Asynchronous $N_{MSB,LSB} = 0$	Asynchronous $N_{MSB,LSB} = \frac{2^{22} \times f_{LRCLK}}{f_{CLK}}$
INTEGER MODE (INT = 1) <i>ICLK and LRCLK must be synchronous and exact integer ratio related</i>	Synchronous $N_{LSB} = \frac{f_{CLK}}{16 \times f_{LRCLK}}, N_{MSB} = 0$	

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

从机工作模式允许 MAX9850 工作在任意音频系统中，LRCLK 与 BCLK 必须由外部时钟源提供。工作在从机模式下时，提供给 MAX9850 的 MCLK 可以与 LRCLK 同步或异步。当 ICLK 同步并是 16 x LRCLK 的整数倍时，使用从机整型模式。整型模式可以确保获得最好的满量程输入信号性能。从机非整型模式提供最大的时钟灵活性。在从机非整型模式下，ICLK 不需要与 LRCLK 同步或是 LRCLK 的整数倍。

主机工作模式下，MAX9850 可以为系统中的其他元件产生并提供 LRCLK 和 BCLK。若提供的 ICLK 是 16 x LRCLK 的整数倍时，使用主机整型模式。整型模式可以确保获得最好的满量程输入信号性能。主机非整型模式下，MAX9850 以优于 ±0.5% 的精度提供任意频率的 LRCLK。

从机非整型模式为 ICLK 和 LRCLK 频率提供了最大的灵活性。ICLK 和 LRCLK 可以是异步的，并可以是非整数倍关系。按照内部定时部分中的表 5，连接一个任意可用的系统时钟。在从机非整型模式下，可接受的 MCLK 频率范围与主机模式相同。

主机整型模式(MAS = 1, IM = 1)

在主机模式下，MAX9850 产生 LRCLK 和 BCLK。LRCLK 是 ICLK 的整数因子，如下式所示：

$$f_{LRCLK} = \frac{f_{ICLK}}{16 \times N_{LSB}}$$

式中：

f_{ICLK} = ICLK 频率。对正常的 DAC 操作， f_{ICLK} 必须至少为 160 x f_{LRCLK} 。

N_{LSB} = LSB(7:0) (寄存器 0x9, B7-B0 位) 中数据的十进制数值。

f_{LRCLK} = LRCLK 频率。

例如：

$f_{ICLK} = 12.228\text{MHz}$ ， $N_{LSB} = 16$ (0x10)， $f_{LRCLK} = 48\text{kHz}$ 。

根据上述方程求解 N_{LSB} 。若 N_{LSB} 是整数则使用主机整型模式。若 N_{LSB} 不是整数，则使用主机非整型模式。

从机整型模式(MAS = 0, IM = 1)

在从机整型模式下，MAX9850 从外部数字音频信号源接收 LRCLK 和 BCLK。为确保正常工作，LRCLK 必须是 ICLK 的整数倍。将 LSB(7:0) (寄存器 0x9, B7-B0 位) 设置为 LRCLK 分频比。使用下式求出 LSB(7:0) 需要设置的值：

$$N_{LSB} = \frac{f_{ICLK}}{16 \times f_{LRCLK}}$$

式中：

f_{ICLK} = ICLK 频率。对正常的 DAC 操作， f_{ICLK} 必须是 160 x f_{LRCLK} 。

f_{LRCLK} = 提供的 LRCLK 频率。

N_{LSB} = LSB(7:0) (寄存器 0x9, B7-B0 位) 中数据的十进制数值。

例如：

$f_{ICLK} = 11.2896\text{MHz}$ ， $f_{LRCLK} = 44.1\text{kHz}$ ， $N_{LSB} = 16$ (0x10)。

根据上述方程求解 N_{LSB} 。若 N_{LSB} 是整数则使用从机整型模式。若 N_{LSB} 不是整数，则使用从机非整型模式。

从机非整型模式(MAS = 0, IM = 0)

在从机非整型模式下，MAX9850 接收外部 LRCLK，并使用允许范围内的任意异步 ICLK 转换数字音频信号。MAX9850 使用内部时钟恢复电路产生所有必需的内部时钟。这样，MAX9850 可以工作在不具备专用时钟信号源或晶振的系统中。实际上可以使用任意的现有系统时钟。为了正常工作， f_{ICLK} 必须至少是 176 x f_{LRCLK} 。

主机非整型模式(MAS = 1, IM = 0)

某些应用中，ICLK 频率可能不是期望的 LRCLK 频率的整数倍。工作在主机非整型模式下时，MAX9850 可以从允许工作范围内的任意 ICLK 频率产生并输出 8kHz 至 48kHz (±0.5%) 间的任意 LRCLK 频率。该模式下，MAX9850 根据 MSB(14:8) 和 LSB(7:0) (寄存器 0x8, B7-B0 位以及寄存器 0x9, B6-B0 位) 中设置的比值，对 MCLK 分频来产生 LRCLK。LRCLK 采样率与 MCLK 之间可以是非整数倍的关系。根据下式计算 MSB(14:8) 和 LSB(7:0)

$$N_{MSB,LSB} = \text{ROUND} \left(\frac{2^{22} \times f_{LRCLK}}{f_{ICLK}} \right)$$

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

式中：

$f_{\text{ICLK}} = \text{ICLK 频率}$ 。对正常的 DAC 操作， f_{ICLK} 必须至少为 $176 \times f_{\text{LRCLK}}$ 。

$f_{\text{LRCLK}} = \text{LRCLK 频率}$ 。

$N_{\text{MSB,LSB}} = \text{MSB}(14:8)$ 和 $\text{LSB}(7:0)$ (寄存器 0x8, B6–B0 位, 以及寄存器 0x9, B7–B0 位) 的十进制数值。

将计算结果四舍五入到最接近的整数。

例如：

$f_{\text{LRCLK}} = 44.1\text{kHz}$, $f_{\text{ICLK}} = 12.288\text{MHz}$ 。

- 1) 求出 $N_{\text{MSB,LSB}}$, 15052.8。
- 2) 将结果四舍五入得到最接近的整数, 15053。
- 3) 转换到十六进制, 0x3CD。
- 4) 设置 MSB(14:8) 为 MSB 0x3A, 设置 LSB(7:0) 为 LSB 0xCD。

表 7 提供了使用主机非整型模式以不同 MCLK 频率产生有效 LRCLK 频率的实例。

电荷泵

MAX9850 的 DirectDrive 线路与耳机输出需要电荷泵来产生内部负电源。在使能寄存器中设置 CPEN(1:0) = 11 (寄存器 0x5, B5 和 B4 位) 可打开电荷泵。CPEN 设置为 11 后约 1.4ms, 电荷泵负电压建立, 音频输出有效。

电荷泵寄存器中 CP(4:0) (寄存器 0x7, B4–B0 位) 的状态决定了电荷泵振荡器是从内部 667kHz 振荡器获取, 还是从 MCLK 获取。设置 CPEN(1:0) = 11 以及 CP(4:0) = 0x00 使能内部振荡器。使能内部振荡器时, 电荷泵的运行与 MCLK 无关, 禁止 DAC 时, 或仅使用线路输入时, 电荷泵仍然工作。

电荷泵的开关频率远远超出音频范围, 不会干扰音频信号。开关驱动器采用特定的技术手段使导通与关断瞬间产生的噪声最小。通过增加 C2 和 PV_{DD} 旁路电容的容量可提高对高频噪声的抑制能力, 不过通常并不需要(见功能框图/典型工作电路)。

根据下式设置 CP(4:0) 为非 0 数值, 可以从 MCLK 获得电荷泵时钟：

$$N_{\text{CP}(4:0)} = \frac{f_{\text{MCLK}}}{2 \times f_{\text{CP}} \times \text{SF}}$$

式中：

$f_{\text{MCLK}} = \text{MCLK 频率}$ 。

$f_{\text{CP}} = \text{电荷泵时钟频率}$ 。为了正常工作, 应确保 $f_{\text{CP}} = 667\text{kHz} \pm 20\%$ 。

SF = MCLK 比例因子。SF 是 IC(1:0) + 1 的十进制数值。

$N_{\text{CP}(4:0)} = \text{CP}(4:0)$ (寄存器 0x7, B4–B0 位) 四舍五入后的十进制数值。从 f_{ICLK} 获得电荷泵时钟时, $N_{\text{CP}(4:0)}$ 必须大于 1。

表 7. 主机非整型模式下的 $N_{\text{MSB,LSB}}$ 实例

MCLK (MHz)	SF	ICLK (MHz)	N (15-BIT hex VALUE)								
			LRCLK OUTPUT FREQUENCY (kHz)								
			48	44.1	32	24	22.05	16	12	11.03	8
18.4320	2	9.2160	5555	4E66	38E4	2AAB	2733	1C72	1555	139A	0E39
16.9344	2	8.4672	5CE1	5555	3DEB	2E71	2AAB	1EF6	1738	1555	0F7B
16.3840	2	8.1920		5833	4000	3000	2C1A	2000	1800	160D	1000
12.5000	1	12.5000	3EEA	39CE	29F1	1F75	1CE7	14F9	0FBB	0E73	0A7C
12.2880	1	12.2880	4000	3ACD	2AAB	2000	1D66	1555	1000	0EB3	0AAB
12.0000	1	12.0000	4189	3C36	2BB1	20C5	1E1B	15D8	1062	0F0E	0AEC
11.2896	1	11.2896	45A9	4000	2E71	22D4	2000	1738	116A	1000	0B9C
9.2160	1	9.2160	5555	4E66	38E4	2AAB	2733	1C72	1555	139A	0E39
8.4672	1	8.4672	5CE1	5555	3DEB	2E71	2AAB	1EF6	1738	1555	0F7B
8.4480	1	8.4480	5D17	5587	3E10	2E8C	2AC3	1F08	1746	1562	0F84

注：N 值表示 MSB(14:8) 和 LSB(7:0) 组合数值。

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

MAX9850

例如：

$f_{MCLK} = 12\text{MHz}$, $SF = 1$, $f_{CP} = 666.7\text{kHz}$, $N_{CP(4:0)} = 9$ 。

表 8 给出了典型 MCLK 频率下推荐使用的 CP(4:0)数值。

寄存器与位说明

11 个内部寄存器用来编程和报告 MAX9850 的状态。表 9 列出了所有寄存器、地址以及上电复位状态。寄存器 0x0 和 0x1 是只读寄存器，其他寄存器均为读/写寄存器。寄存器 0xB 保留用于工厂测试。

状态寄存器(0x0, 0x1)

表 8. 典型 MCLK 频率下推荐使用的 CP(4:0)数值

f _{MCLK} (MHz)	CP(4:0)	IC(1:0)	SF	f _{CP} (kHz)
11.2896	0x08	0x0	1	705.6
12.0000	0x09	0x0	1	666.7
12.2880	0x09	0x0	1	682.7
13.0000	0x0A	0x0	1	650.0
24.0000	0x09	0x1	2	666.7
27.0000	0x07	0x2	3	642.9

表 9. 寄存器映像表

REGISTER	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	REGISTER ADDRESS	POWER-ON RESET STATE
Status A	ALERT	SGPIO	LCK	SHPS	VMN	1	IOHL	IOHR	0x0	—
Status B	X	X	X	SMONO	SHP	SLO	SLI	SDAC	0x1	—
Volume	MUTE	SLEW	VOL(5:0)						0x2	0x0C
General Purpose	GM(1:0)		GPD	DBDEL(1:0)		MONO	0	ZDEN	0x3	0x00
Interrupt Enable	0	ISGPIO	ILCK	ISHPS	IVMN	0	0	IIOH	0x4	0x00
Enable	SHDN	MCLKEN	CPEN(1:0)		HPEN	LNOEN	LNIEN	DACEN	0x5	0x00
Clock	0	0	0	0	IC(1:0)		0	0	0x6	0x00
Charge Pump	SR(1:0)		0	CP(4:0)					0x7	0x00
LRCLK MSB	INT	MSB(14:8)							0x8	0x00
LRCLK LSB	LSB(7:0)								0x9	0x00
Digital Audio	MAS	INV	BCINV	LSF	DLY	RTJ	WS(1:0)		0xA	0x00
RESERVED									0xB	—

X = 无关。

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

报警标志(ALERT)

表 10. 状态 A 只读寄存器(0x0)位说明

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ALERT	SGPIO	LCK	SHPS	VMN	1	IOHL	IOHR

1 = 出现中断事件。

0 = 没有中断事件。

ALERT 是报警标志，中断事件发生时置位。可使 ALERT 置位的事件如下：

- SGPIO 状态变化，GPIO 配置为输入时，表示 GPIO 上的电平发生了变化。将 GPIO 配置为输入，并在中断使能寄存器中设置 ISGPIO = 1 (寄存器 0x4, B6 位)。
- 内部 PLL 与 LRCLK 锁定或失锁。在中断使能寄存器中设置 ILCK = 1 (寄存器 0x4, B5 位)。
- SHPS 状态变化，表示耳机被接入或断开。在中断使能寄存器中设置 ISHPS = 1 (寄存器 0x4, B4 位)。
- 耳机放大器达到最小音量。在中断使能寄存器中设置 IVMN = 1 (寄存器 0x4, B3 位)。
- 右或左耳机输出(HPR、HPL)过载。在中断使能寄存器中设置 IIOH = 1 (寄存器 0x4, B0 位)。

事件发生后，ALERT 置 1，并保持置位状态，直到读取状态 A 寄存器。配置为输出的 GPIO 在 ALERT 事件发生时向 μ C 发出中断。GPIO 寄存器中的 GM(1:0) (寄存器 0x3, B7 和 B6 位) 控制 GPIO 的输出模式。将 GPIO 设置为输出的详细信息参见 GPIO 部分。

GPIO 状态(SGPIO)

1 = GPIO 为高。

0 = GPIO 为低。

读取状态 A 寄存器时，SGPIO 报告 GPIO 的状态，这与 GPIO 设置为输入或输出无关。GPIO 配置为输入，且中断使能寄存器中 ISGPIO = 1 (寄存器 0x4, B6 位) 时，SGPIO 状态的变化将使 ALERT 置 1。

PLL 锁定状态(LCK)

1 = 内部 PLL 锁定到 LRCLK。

0 = 内部 PLL 未锁定到 LRCLK。

读取状态 A 寄存器时，LCK 报告内部 PLL 的锁定状态。PLL 未锁定时，DAC 禁止工作。PLL 与 LRCLK 锁定时，若 DACEN 等于 1 (寄存器 0x5, B0 位)，则 DAC 开始工作。若中断使能寄存器中 ILCK = 1 (寄存器 0x4, B5 位)，LCK 状态变化时 ALERT 置 1。

HPS 状态(SHPS)

1 = HPS 为高，表明耳机已连接。

0 = HPS 为低，表明没有耳机连接。

读取状态 A 寄存器时，SHPS 报告 HPS 去抖后的状态。SHPS = 0 表明没有耳机连接，HPS 为低。HPS 为高时，SHPS 置 1，表明耳机已连接。若中断使能寄存器中的 ISHPS = 1 (寄存器 0x4, B4 位)，则 SHPS 状态变化时，ALERT 置 1。

最低音量(VMN)

1 = 耳机音量已达到最小值。

0 = 耳机音量未达到最小值。

当耳机放大器音量达到最小时，VMN 置 1。中断使能寄存器中的 IVMN = 1 (寄存器 0x4, B3 位) 时，ALERT 置 1。

左耳机过流(IOHL)

1 = 左耳机输出(HPL)经历过一次过流。

0 = 左耳机输出(HPL)正常。

左耳机输出 HPL 上出现过流时，IOHL 置 1，并保持置位，直到读取状态 A 寄存器。若中断使能寄存器中 IIOH = 1 (寄存器 0x4, B0 位)，则当右或左耳机输出出现过流时，ALERT 置 1。

右耳机过流(IOHR)

1 = 右耳机输出(HPR)经历过一次过流。

0 = 右耳机输出(HPR)正常工作。

右耳机出现过流时，IOHR 置 1，并保持置位，直到读取状态 A 寄存器。若中断使能寄存器中 IIOH = 1 (寄存器 0x4, B0 位)，则当右或左耳机输出出现过流时，ALERT 置 1。

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

表 11. 状态 B 只读寄存器(0x1)位说明

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
X	X	X	SMONO	SHP	SLO	SLI	SDAC

单声道状态(SMONO)

1 = 耳机放大器输出处于单声道模式。

0 = 耳机放大器输出处于立体声模式。

SMONO 说明耳机放大器输出处于单声道还是立体声模式。在单声道模式下，左右声道音频信号混合，并从左耳机输出。在通用寄存器中设置 MONO = 1 (寄存器 0x3, B2 位) 进入单声道模式。

耳机放大器状态(SHP)

0 = 耳机放大器正在工作。

1 = 耳机放大器没有工作。

SHP 说明耳机放大器是否处于工作状态。

线路输出状态(SLO)

0 = 使能线路输出。

1 = 禁止线路输出。

SLO 说明线路输出处于使能还是禁止状态。在使能寄存器中设置 LNOEN = 1 (寄存器 0x5, B2 位)，使能线路输出。

线路输入状态(SLI)

0 = 使能线路输入。

1 = 禁止线路输入。

SLI 说明线路输入处于使能还是禁止状态。在使能寄存器中设置 LNIEN = 1 (寄存器 0x5, B1 位)，使能线路输入。

DAC 状态(SDAC)

0 = DAC 正在工作，并已完成软启动。

1 = DAC 未工作，并已完成软停止。

SDAC 说明 DAC 处于工作状态并接收有效时钟信号，还是未处于工作状态。

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

音量寄存器(0x2)

表 12. 音量(0x2)读/写寄存器位说明

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
MUTE	SLEW	VOL(5:0)					

1 = 耳机输出静音。

0 = 耳机输出未静音。

设置 MUTE = 1 使耳机输出静音(HPR, HPL)。若使能了
过零检测, 则当音频信号第一次过零时耳机输出静音。

静音使能(MUTE)

摆率控制使能(SLEW)

1 = 使能摆率控制。

0 = 禁止摆率控制。

摆率控制可使耳机放大器在不同音量间平滑变化。禁止
摆率控制时, 音量立即发生变化。

音量控制(VOL(5:0))

VOL(5:0)控制耳机放大器的音量衰减量。代码 0x00 为最大
音量, 而 0x28 至 0x3F 为完全衰减。当代码设置为 0x3F
且达到最低音量时, VMN 置 1。表 13 列出了每个代码对
应的音量衰减量。

表 13. 音量控制设置

VOL(5:0)	SETTING (dB)
0x00	+6.0
0x01	+5.5
0x02	+5.0
0x03	+4.5
0x04	+4.0
0x05	+3.5
0x06	+3.0
0x07	+2.5
0x08	+1.5
0x09	+0.5
0x0A	-0.5
0x0B	-1.5
0x0C	-3.5
0x0D	-5.5

VOL(5:0)	SETTING (dB)
0x0E	-7.5
0x0F	-9.5
0x10	-11.5
0x11	-13.5
0x12	-15.5
0x13	-17.5
0x14	-19.5
0x15	-21.5
0x16	-23.5
0x17	-25.5
0x18	-27.5
0x19	-29.5
0x1A	-31.5
0x1B	-33.5

VOL(5:0)	SETTING (dB)
0x1C	-35.5
0x1D	-37.5
0x1E	-39.5
0x1F	-41.5
0x20	-45.5
0x21	-49.5
0x22	-53.5
0x23	-57.5
0x24	-61.5
0x25	-65.5
0x26	-69.5
0x27	-73.5
0x28-0x3F	Mute
—	—

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

通用寄存器

表 14. 通用读/写寄存器(0x3)位说明

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
GM(1:0)		GPD	DBDEL(1:0)		MONO	0	ZDEN

GPIO 输出模式控制(GM(1:0))

- 00 = GPIO 输出低。
- 01 = GPIO 为高阻。
- 10 = GPIO 输出低，且使能 ALERT 输出脉冲功能。
- 11 = GPIO 为高阻，且使能 ALERT 输出脉冲功能。

GM(1:0) 设置 GPIO 输出状态，并使能或禁止 ALERT 输出脉冲功能。开漏极 GPIO 输出可以设置为输出静态高或低。GPIO 还可以设置为出现报警时，输出电平与设定输出状态反相的脉冲。状态 A 寄存器中 ALERT 置 1 时，出现报警。GPIO 配置为输入时，GM(1:0) 功能无效。

GPIO 方向(GPD)

- 1 = 配置 GPIO 为开漏极输出。
 - 0 = 配置 GPIO 为输入。
- GPD 状态决定了 GPIO 是输入还是输出。

去抖动延时控制(DBDEL(1:0))

- 00 = 禁止 HPS 去抖动延时。
- 01 = HPS 去抖动延时为 200ms。
- 10 = HPS 去抖动延时为 400ms。
- 11 = HPS 去抖动延时为 800ms。

DBDEL(1:0) 控制 HPS 去抖动时间长度。去抖动时间由电荷泵时钟导出。

单声道模式使能(MONO)

- 1 = 使能单声道模式。
 - 0 = 禁止单声道模式，耳机输出为立体声模式。
- 设置 MONO = 1 强制耳机输出为单声道模式。立体声输入信号相加得到单声道信号。叠加的信号从左耳机输出端 (HPL) 输出。

过零检测使能(ZDEN)

- 1 = 使能过零检测功能。
- 0 = 禁止过零检测功能。

ZDEN = 1 时，音量变化、耳机输出静音、进入/退出关断等只能发生在音频信号的过零点。为获得最佳性能，设置 SR(1:0) 为 01。

中断使能寄存器

表 15. 中断使能读/写寄存器(0x4)位说明

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
0	ISGPIO	ILCK	ISHPS	IVMN	0	0	IIOH

注意：下列中断均可配置为通过 GPIO 触发硬件中断。设置通用寄存器中的 GPD 与 GM(1:0)，使能 ALERT 输出脉冲功能。

SGPIO 中断使能(ISGPIO)

- 1 = GPIO 为输入时，SGPIO 的状态变化将使 ALERT 置 1。
 - 0 = GPIO 为输入时，SGPIO 的状态变化不使 ALERT 置位。
- 若 ISGPIO = 1，当 SGPIO 状态变化时 MAX9850 设置 ALERT = 1。该中断仅在 GPIO 为输入时有效。

PLL 锁定中断使能(ILCK)

- 1 = LCK 的状态变化将使 ALERT 置 1。
 - 0 = LCK 的状态变化不使 ALERT 置位。
- 若 ILCK = 1，当 DAC 的内部 PLL 失锁或锁定到 LRCLK 时 MAX9850 设置 ALERT = 1。当 GPD = 1 时，配置 GM(1:0) 将 GPIO 配置为硬件中断，LCK 状态变化时通知 μ C。

SHPS 中断使能(ISHPS)

- 1 = SHPS 的状态变化将使 ALERT 置 1。
 - 0 = SHPS 的状态变化不使 ALERT 置位。
- 若 ISHPS = 1，当 SHPS 状态变化时 MAX9850 设置 ALERT = 1。

最小音量中断使能(IVMN)

- 1 = VMN 的状态变化将使 ALERT 置 1。
 - 0 = VMN 的状态变化不使 ALERT 置位。
- 若 IVMN = 1，当耳机放大器到达最小输出音量时 MAX9850 设置 ALERT = 1。当 GPD = 1 时，设置 GM(1:0) 配置 GPIO 为硬件中断，当耳机输出音量经过配置并达到其最小值时，通知 μ C。

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

耳机过流中断使能(IIOH)

1 = IOHL 或 IOHR 置 1 时, ALERT 置 1。

0 = IOHL 或 IOHR 置 1 时, ALERT 不置位。

若 IIOH = 1, 当一个或两个耳机放大器输出(HPL、HPR) 出现过流状态时, MAX9850 设置 ALERT = 1。当 GPD = 1 时, 设置 GM(1:0) 配置 GPIO 为硬件中断, 当耳机输出发生过流条件时, 通知 μ C。

使能寄存器

表 16. 使能读/写寄存器(0x5)位说明

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SHDN	MCLKEN	CPEN (1:0)	HPEN	LNOEN	LNIEN	DACEN	

关断($\overline{\text{SHDN}}$)

1 = MAX9850 上电。

0 = MAX9850 处于低功耗关断模式。I²C 接口保持有效。

设置 $\overline{\text{SHDN}} = 1$ 使 MAX9850 上电。耳机放大器、主时钟、线路输入/输出、DAC、电荷泵和电荷泵时钟均有各自的使能位。只有在 $\overline{\text{SHDN}} = 1$ 后, MAX9850 的各个部分才能使能。

MCLK 使能(MCLKEN)

1 = MCLK 连接到 MAX9850。

0 = MCLK 从 MAX9850 断开。

为了使 DAC 正常工作, MCLKEN 必须置 1。MCLKEN = 0 时, 线路输入/输出与耳机放大器仍能工作, 但前提是电荷泵时钟从内部振荡器获得。

电荷泵使能(CPEN(1:0))

11 = 使能内部电荷泵。

00 = 禁止内部电荷泵。

10 与 01 = 无效。

使用线路输出与耳机放大器时, 设置 CPEN(1:0) 为 11 使能电荷泵。

耳机输出使能(HPEN)

1 = 使能耳机输出。

0 = 禁止耳机输出。

设置 HPEN = 1 使能耳机输出。HPEN = 0 使耳机输出为高阻。为了使耳机放大器正常工作, 必须使能线路输出。

线路输出使能(LNOEN)

1 = 使能线路输出。

0 = 禁止线路输出。

LNOEN = 0 强制线路输出与耳机输出为高阻。设置 LNOEN = 1 使能线路输出。为了使耳机放大器正常工作, 必须使能线路输出。

线路输入使能(LNIEN)

1 = 使能线路输入。

0 = 禁止线路输入。

LNIEN = 1 使能线路输入。LNIEN = 0 禁止线路输入。

DAC 使能(DACEN)

1 = 使能音频 DAC。

0 = 禁止音频 DAC。

DACEN = 1 使能 DAC 以及所有支持电路, 包括数字音频接口和内插 FIR 滤波器。DACEN = 0 使 DAC 与支持电路进入低功耗关断模式。

时钟寄存器

表 17. 时钟读/写寄存器(0x6)位说明

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
0	0	0	0	IC(1:0)	0	0	0

内部时钟分频(IC(1:0))

00 = 内部时钟分频器透明传输($f_{\text{ICLK}} = f_{\text{MCLK}}$)。

01 = ($f_{\text{ICLK}} = f_{\text{MCLK}} / 2$)。

10 = ($f_{\text{ICLK}} = f_{\text{MCLK}} / 3$)。

11 = ($f_{\text{ICLK}} = f_{\text{MCLK}} / 4$)。

IC(1:0) 控制内部时钟分频器, 决定从主时钟获得的内部时钟频率。

电荷泵寄存器

表 18. 电荷泵读/写寄存器(0x7)位说明

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SR(1:0)		0	CP(4:0)				

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

摆率控制(SR(1:0))

00 = 耳机音量在 63μs 内从代码 0x00 变化到 0x28。当 ZDEN = 1 时，不推荐使用。

01 = 耳机音量在 125ms 内从代码 0x00 变化到 0x28。

10 = 耳机音量在 63ms 内从代码 0x00 变化到 0x28。

11 = 耳机音量在 42ms 内从代码 0x00 变化到 0x28。

设置 SR(1:0) 来设定 MAX9850 在两个音量间变化的速率。摆率控制还控制耳机输出从给出命令到静音或关断的时间。

电荷泵时钟分频器(CP(4:0))

CP(4:0) 控制电荷泵时钟分频器。电荷泵时钟频率(f_{CPCLK}) 从 ICLK 或内部振荡器获取。

设置 CP(4:0) = 0x00，使能 667kHz 内部振荡器。这就使耳机放大器和线路输出在 DAC 禁止时仍能工作。

设置 CP(4:0) 为 0x00 以外的值将禁止内部振荡器，并从 ICLK 获取电荷泵时钟。根据下式确定从 ICLK 产生 667kHz $\pm 20\%$ 电荷泵时钟的 CP(4:0) 数值：

$$f_{CP} = \frac{f_{MCLK}}{2 \times N_{CP(4:0)} \times SF}$$

式中：

f_{MCLK} = MCLK 频率。

$N_{CP(4:0)}$ = CP(4:0) 的十进制数值。从 ICLK 获得电荷泵时钟时， $N_{CP(4:0)}$ 必须大于 1。

f_{CP} = 电荷泵时钟频率。为了正常工作，应确保 f_{CP} = 667kHz $\pm 20\%$ 。

SF = MCLK 比例因子。SF 是 IC(1:0) + 1 的十进制数值。

LRCLK MSB 与 LRCLK LSB 寄存器

表 19. LRCLK MSB (0x8) 与 LRCLK LSB (0x9) 读/写寄存器位说明

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INT	MSB(14:8)						
							LSB(7:0)

整型模式(INT)

1 = 配置 MAX9850 为整型模式。

0 = 配置 MAX9850 为非整型模式。

整型模式工作要求 ICLK 是 16 倍采样率(f_{LRCLK}) 的整数倍。参见 DAC 工作模式部分。整型模式下， $f_{LRCLK} = f_{ICLK} / (16 \times LSB(7:0))$ 。

LRCLK MSB 分频器(MSB(14:8))

只有在非整型模式下，才由 MSB(14:8) 和 LSB(7:0) 来确定 f_{LRCLK} (参见 DAC 工作模式部分)。非整型模式下有：

$$N_{MSB,LSB} = \frac{2^{22} \times f_{LRCLK}}{f_{ICLK}}$$

LRCLK LSB 分频器(LSB(7:0))

MAX9850 配置为非整型模式时，LSB(7:0) 与 MSB(14:8) 一起用来设置 LRCLK 分频器。MAX9850 配置为整型模式时，只用 LSB(7:0) 来确定 f_{LRCLK} 。参见 DAC 工作模式部分。

数字音频寄存器

表 20. 数字音频读/写寄存器(0xA)位说明

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
MAS	INV	BCINV	LSF	DLY	RTJ	WS(1:0)	

主机模式(MAS)

1 = 配置 MAX9850 为主机模式。

0 = 配置 MAX9850 为从机模式。

设置 MAS = 1 配置 MAX9850 为主机模式。主机模式下，LRCLK 和 BCLK 由 MAX9850 产生。设置 MAS = 0 配置 MAX9850 作为数字音频从机，从外部数字音频信号源接收 LRCLK 和 BCLK。

LRCLK 反相(INV)

1 = LRCLK 为高时送入左声道音频数据；LRCLK 为低时送入右声道数据。

0 = LRCLK 为低时送入左声道音频数据；LRCLK 为高时送入右声道数据。

设置 INV = 0，以满足 I²S 标准。

位时钟反相(BCINV)

1 = BCLK 的下降沿锁存 SDIN 上的数据。

0 = BCLK 的上升沿锁存 SDIN 上的数据。

设置 BCIINV = 0，以满足 I²S 标准。

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

低位先行(LSF)

1 = 首先接收音频数据的 LSB。
0 = 首先接收音频数据的 MSB。
设置 LSF = 0，以满足 I²S 标准。

SDIN 延时(DLY)

1 = LRCLK 跳变后，在第二个 BCLK 的上升沿，音频数据锁存到 MAX9850。
0 = A LRCLK 跳变后，在第一个 BCLK 的上升沿，音频数据锁存到 MAX9850。
设置 DLY = 1，以满足 I²S 标准。

右对齐数据(RTJ)

1 = 音频数据右对齐。
0 = 音频数据左对齐。
I²S 数据为左对齐，设置 RTJ = 0，以符合 I²S 标准的要求。

字长选择(WS(1:0))

00 = 音频字长为 16 位。
01 = 音频字长为 18 位。
10 = 音频字长为 20 位。
11 = 音频字长为 24 位。

通过设置 WS(1:0) 来选择输入数据的字长。音频数据字长的设置确保了接收输入数据字时输出正确的 BCLK 周期数。

数字音频接口

MAX9850 通过 3 线接口接收串行数字音频数据。数据可以是右对齐或左对齐，MSB 或 LSB 先行，或 I²S 兼容格式。3 线串行总线包含两个分时复用的音频通道(SDIN)、通道选择线(LRCLK)和位时钟线(BCLK)。音频接口的配置由数字音频寄存器来控制，见表 20。表 21 列出了典型

表 21. 音频数据字长

FORMAT	DIGITAL AUDIO REGISTER CODE (0xA)
Left-Justified Audio Data	X0000000
Right-Justified Audio Data	X0000100
I ² S-Compatible Audio Data	X0001000

的数字音频格式、所需的数字音频寄存器代码。图 4 说明了右对齐、左对齐和 I²S 兼容音频数据之间的区别。

主机模式下，MAX9850 通过 ICLK 产生 BCLK 和 LRCLK，见内部定时部分。从机模式下，MAX9850 从外部数字音频信号源接收 LRCLK 和 BCLK。

工作在从机模式时，MAX9850 能够以超出 WS(1:0) 中设置的额外 BCLK 脉冲接收右对齐或左对齐的数据。使用 I²S 标准时，音频数据最高有效位必须在 LRCLK 跳变后的第二个 BCLK 的上升沿锁存到 SDIN。MAX9850 支持的时钟与数据之间的时序关系见图 4。

MAX9850 可以配置用来接收 16、18、20 或 24 位数据。主机模式下，MAX9850 恰好产生所设置的 BCLK 周期数。根据表 22，用 WS(1:0) (寄存器 0xA，B0 和 B1 位) 设置音频数据字长，以确保 MAX9850 输出正确的 BCLK 周期数，用来接收输入数据字。

表 22. 音频数据字长

WS(1:0)	DATA WORD SIZE (BITS)
0x0	16
0x1	18
0x2	20
0x3	24

内部数字处理分辨率为 18 位宽。超过 18 位的数据字将被截断。比设定字长短的数据字，将由内部在缺少的位置补 0。

I²C 兼容串行接口

MAX9850 具有 I²C/SMBus™ 兼容的 2 线串行接口，接口由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成。通过 SDA 和 SCL，MAX9850 能够以高达 400kHz 的时钟速率与主机通信。图 5 所示为 2 线接口时序图。主机产生 SCL 并启动总线上的数据传输。

主机向 MAX9850 写入数据时，首先发送正确的从机地址，接下来发送寄存器地址，然后是数据字。每个传输序列由 START (S) 或 REPEATED START (Sr) 条件和 STOP (P) 条件构建成帧。发送到 MAX9850 的每个字都是 8 位长，并跟随一个应答时钟脉冲。

SMBus 是 Intel Corp. 的商标。

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

MAX9850

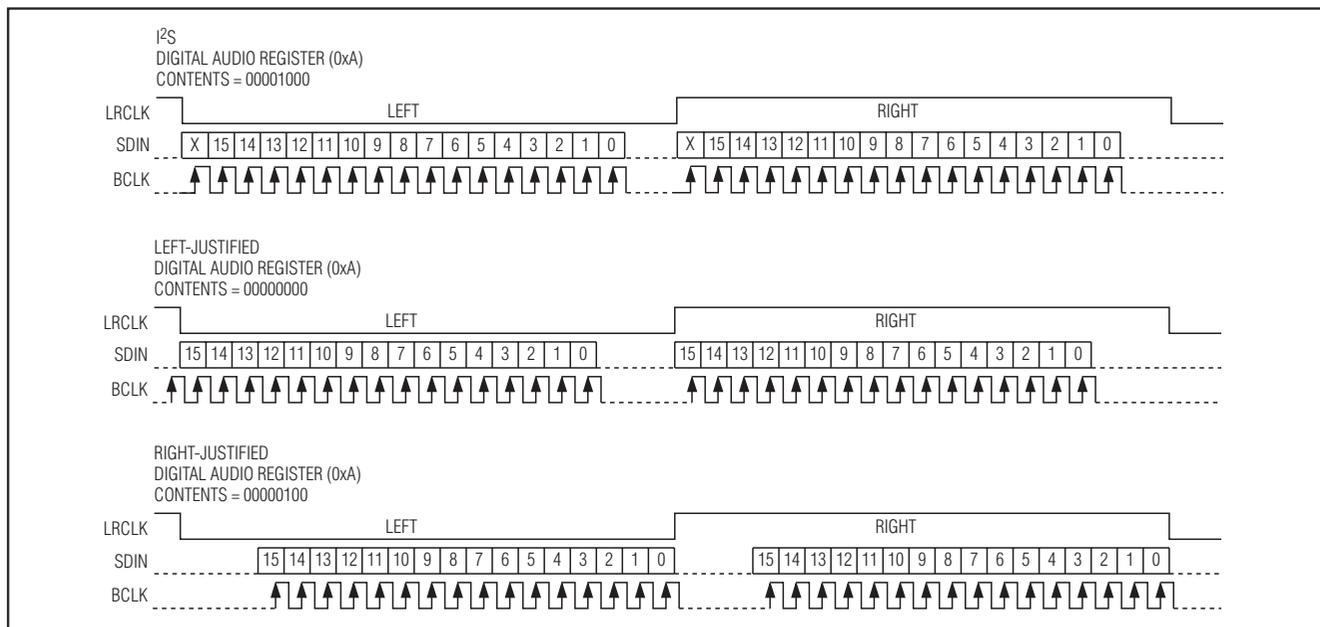


图4. 右对齐、左对齐音频数据格式(从机模式, 16位数据)

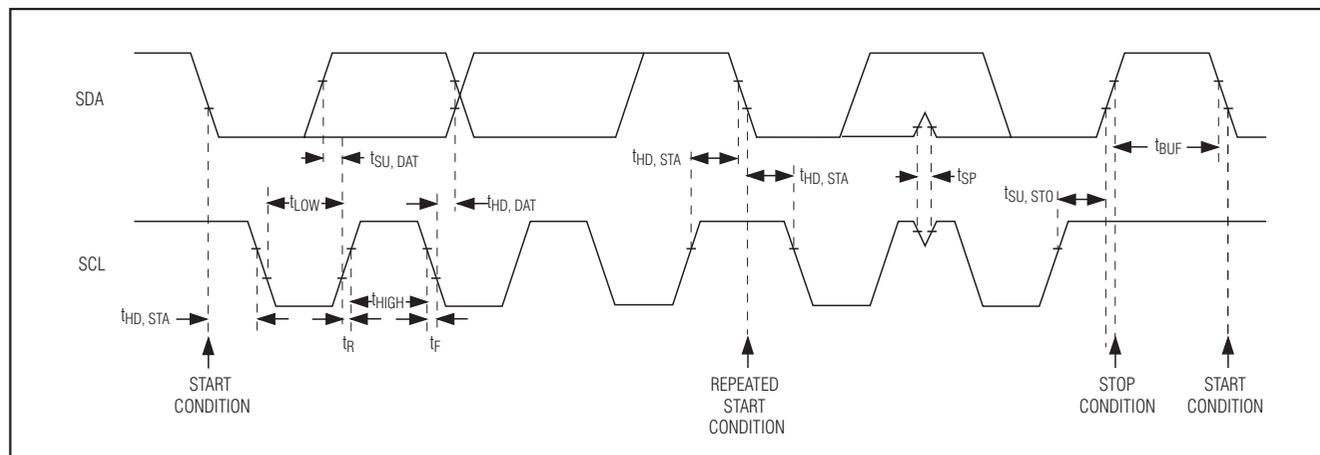


图5. 2线接口时序图

从 MAX9850 读取数据的主机发送正确的从机地址，并跟随一串共 9 个 SCL 脉冲。MAX9850 与主机产生的 SCL 脉冲同步地向 SDA 发送数据。主机收到每个数据字节时应应答。每个读时序由 START 或 REPEATED START 条件、非应答和一个 STOP 条件构成。

SDA 可以用作输入和开漏极输出。SDA 总线需要典型值大于 500Ω 的上拉电阻。SCL 只能用作输入。若总线上有多个主机，或单主机系统的主机使用开漏极 SCL 输出，则 SCL 需要典型值大于 500Ω 的上拉电阻。SDA 与 SCL 线

上的串联电阻是可选的。串联电阻保护 MAX9850 的数字输入免受总线上高电压尖峰影响，并减小串扰与总线信号的负尖峰。

位传输

每个 SCL 周期中传输 1 个数据位。SDA 上的数据在 SCL 脉冲高电平期间必须保持稳定。SCL 为高时 SDA 上的变化表示控制信号(见 START 与 STOP 条件部分)。I²C 总线空闲时，SDA 和 SCL 的空闲状态为高。

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

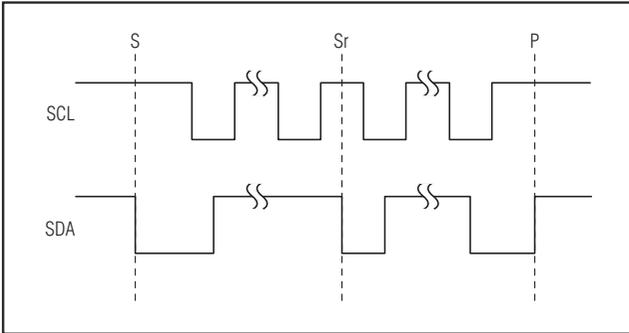


图6. START、STOP 和 REPEATED START 条件

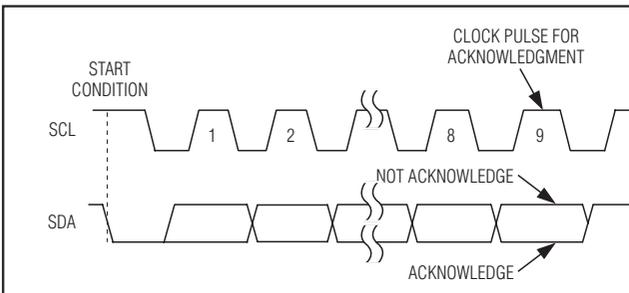


图7. 应答

START 与 STOP 条件

不使用总线时，SDA 和 SCL 的空闲状态为高。主机通过发出 START 条件来启动通信。START 条件是 SCL 为高时，SDA 上由高到低的跳变。STOP 条件是 SCL 为高时，SDA 上低到高的跳变(图6)。来自主机的 START 条件通知 MAX9850 一次传输的开始。主机通过发出 STOP 条件终止传输并释放总线。若产生的是 REPEATED START 条件，而不是 STOP 条件，则总线保持有效。

提前 STOP 条件

MAX9850 在数据传输过程中可随时识别 STOP 条件，除非 STOP 条件与 START 条件出现在同一个高脉冲期间。为了正常工作，不要在同一个 SCL 高脉冲期间发送 START 条件和 STOP 条件。

表 23. MAX9850 地址映射

ADD	MAX9850 SLAVE ADDRESS							R/ \bar{W}
	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
GND	0	0	1	0	0	0	0	X
AVDD	0	0	1	0	0	0	1	X
SDA	0	0	1	0	0	1	1	X

X = 无关。

从机地址

MAX9850 可以设置为三个从机地址之一(见表 23)。这些从机地址是唯一的器件 ID。将 ADD 连至 GND、AVDD 或 SDA 来设置 I²C 从机地址。地址定义为 7 个最高有效位(MSB)后紧接着 R/ \bar{W} 位。将 R/ \bar{W} 位置 1 配置 MAX9850 为读模式。将 R/ \bar{W} 位清 0 配置 MAX9850 为写模式。地址是 START 条件之后发送到 MAX9850 的第一字节信息。

应答

应答位(ACK)是与时钟脉冲对应的第 9 位，是在写模式下 MAX9850 对接收的每个数据字节产生的握手(见图 7)。若前一字节成功接收，MAX9850 则在主机产生的整个第 9 个时钟脉冲过程中拉低 SDA。监视 ACK 可以检测失败的数据传输。若接收器件忙或出现系统故障，则会出现失败的数据传输。万一出现失败的数据传输，总线主机可能重试通信。

MAX9850 处于读模式时，主机在第 9 个时钟周期中拉低 SDA，作为接收数据的应答。每个读字节后，主机发送应答，允许数据传输继续进行。主机从 MAX9850 读取最后一个数据字节时，发送非应答和后续的 STOP 条件。

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

MAX9850

写数据格式

对 MAX9850 的写操作包括 START 条件、R/W 位清 0 的从机地址(参见表 23)、用来配置内部寄存器地址指针的一个数据字节、一个或多个数据字节以及 STOP 条件的传输。图 8 说明了向 MAX9850 写一个数据字节的正确帧格式。图 9 说明了向 MAX9850 写 n 个数据字节的帧格式。

R/W 位清 0 的从机地址说明主机将向 MAX9850 写数据。MAX9850 在主机产生的第 9 个 SCL 脉冲过程中，对接收的地址字节作出应答。

主机发送的第 2 个字节用来配置 MAX9850 的内部寄存器地址指针。该指针通知 MAX9850 写下一数据字节的位置。MAX9850 收到地址指针数据时发送应答脉冲。

发送到 MAX9850 的第 3 个字节包含将要写入选定寄存器的数据。MAX9850 发出的应答脉冲说明接收到该数据字节。每次接收到数据字节后，地址指针自动递增到下一个寄存器地址。该自动递增特性允许主机在一个连续帧内写一串寄存器。图 9 说明了如何用 1 帧写多个寄存器。主机发出 STOP 条件说明传输结束。

大于 0xA 的寄存器地址是保留的。不要写这些地址。

读数据格式

发送 R/W 位为 1 的从机地址启动一次读操作。MAX9850 在第 9 个 SCL 时钟脉冲过程中拉低 SDA，作为接收到从机地址的应答。紧跟读命令之后的 START 条件将地址指针复位到寄存器 0x0。MAX9850 发送的第一个字节是寄存器 0x0 的内容。发送的数据在主机产生的串行时钟 (SCL) 上升沿有效。每次读取数据字节后，地址指针自动递增。自动递增特性允许在一个连续帧内顺序读取所有寄存器。

读取一些数据字节后可以发送 STOP 条件。若发出 STOP 条件后紧接着另一个读操作，则读取的第一个数据字节来自寄存器 0x0，并且接下来的读操作将使地址指针递增，直到下一个 STOP 条件。

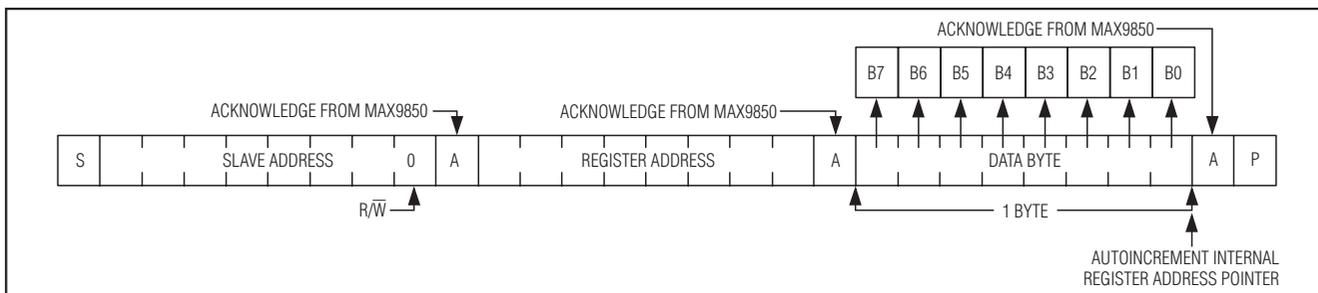


图 8. 向 MAX9850 写一个数据字节

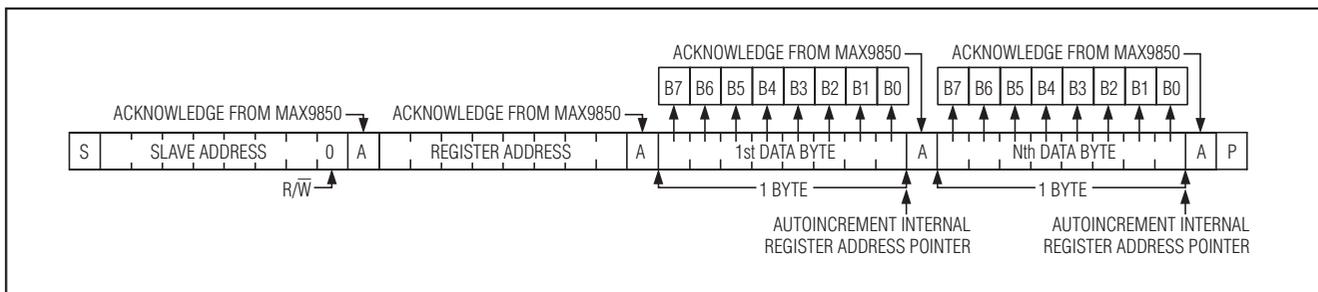


图 9. 向 MAX9850 写 n 个数据字节

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

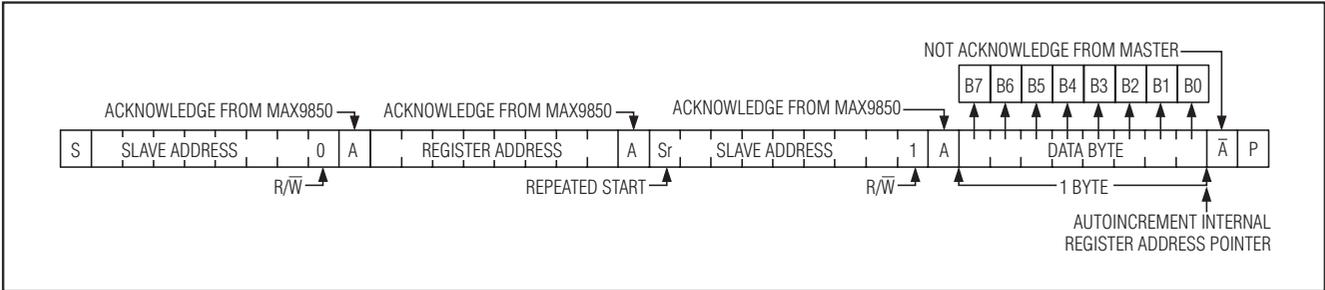


图 10. 从 MAX9850 读一个数据字节

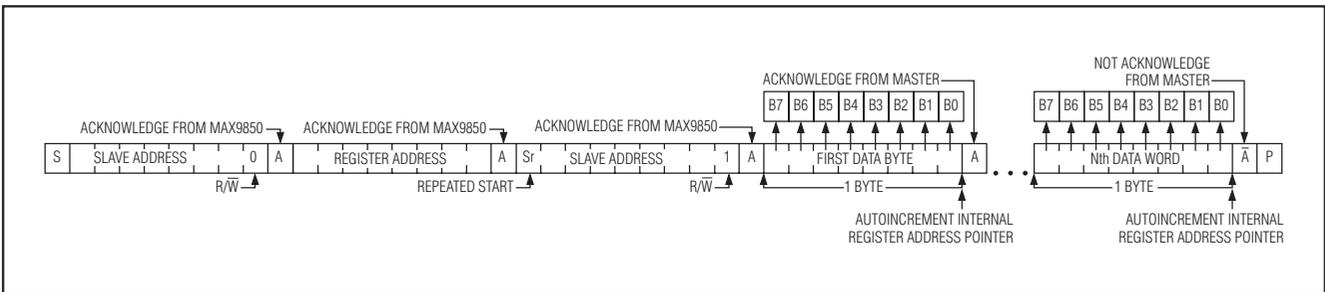


图 11. 从 MAX9850 读 n 个字节

在发出读命令之前，可以将地址指针预置到指定寄存器。主机预置地址指针的过程是，首先发送 R/\bar{W} 为 0 的 MAX9850 从机地址，紧接着发送寄存器地址。然后发送 REPEATED START 条件，紧接着是 R/\bar{W} 位为 1 的从机地址。MAX9850 发送指定寄存器的内容。发送第一个字节后，地址指针自动递增。试图读取地址高于 0xB 寄存器的命令将导致反复读取 0xB。请注意 0xB 是保留寄存器。

主机在应答时脉冲内对接收到的每个读字节作出应答。主机必须对最后一个字节以外的所有正确接收的字节作出应答。最后一个字节必须紧跟一个来自主机的非应答，然后是 STOP 条件。图 10 说明了从 MAX9850 读取一个字节的帧格式。图 11 说明了从 MAX9850 读取多个字节的帧格式。

应用信息

MAX9850 的上电/断电

MAX9850 在低功耗关断模式下上电时，DAC、耳机、线路输入与输出均禁止。为了使必要的电路有效工作，需要使用使能寄存器中的 CPEN(1:0) (寄存器 0x5, B5 和 B4

位)激活电荷泵。在使能寄存器中设置适当的位，将使能 MAX9850 中期望的电路功能。最后需要将整体关断位 SHDN (寄存器 0x5, B7 位)置 1。可以通过一次 I²C 写操作置位所有使能位。

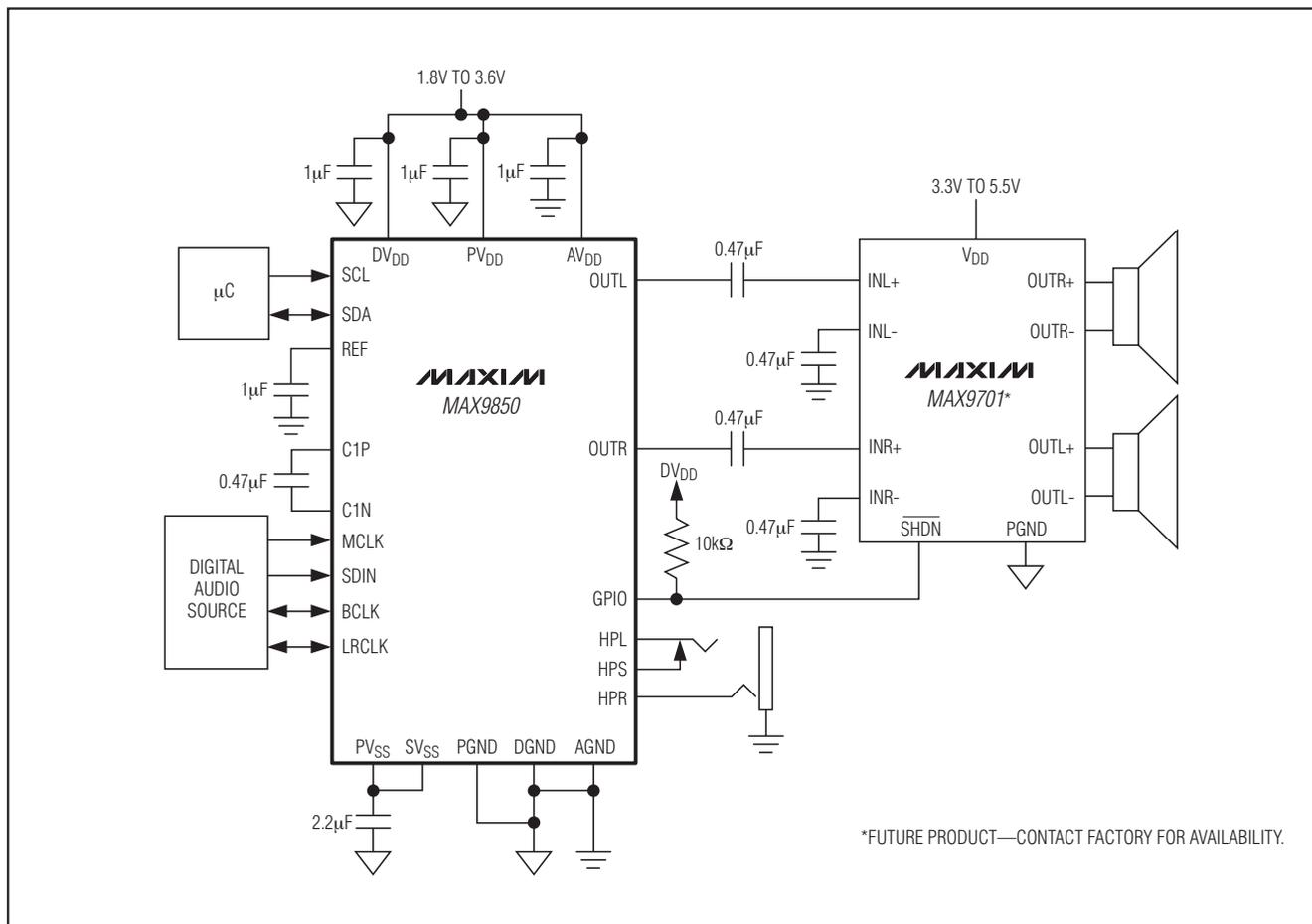
将 MAX9850 从关断中唤醒之前，配置 I²C 寄存器是良好的习惯。其中包括设置初始音量、DAC 工作模式、立体声或单声道工作以及音频接口设置。设置好所有寄存器后再使 MAX9850 上电将确保音频输出不中断。

一旦向使能寄存器写入合适的字节，电荷泵便启动并建立内部电源电压。电荷泵使能后约 10ms，MAX9850 将做好工作准备。在这段时间里，选定的耳机输出也将完成无杂音的上电时序。一旦耳机做好工作准备，则耳机放大器状态位 (SHP) (寄存器 0x1, B3 位)置 1。线路输入与输出若被使能，也将在这 10ms 启动周期内导通。

在使能线路输入放大器之前，应等待交流耦合电容稳定。即便 MAX9850 处于关断状态下，输入耦合电容也会充电至驱动器件的输出偏置电压。在绝大多数应用中，系统上电后，输入 AC 耦合电容立刻被充电，并可以使用。

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

MAX9850



*FUTURE PRODUCT—CONTACT FACTORY FOR AVAILABILITY.

图 12. 立体声扬声器

在被使能并接收 32 个 LRCLK 周期后，DAC 开始其软启动过程。所有内部滤波器被启动，DAC 增益逐步上升至最大。MAX9850 耳机输出由耳机放大器音量设置决定。

MAX9850 断电前，通过将 MUTE (寄存器 0x2, B7 位) 置 1，静音音频输出。逐渐降低音量至最大衰减量，是输出静音的另一种方法。输出达到最大衰减时，状态 A 寄存器中的 VMN (寄存器 0x0, B3 位) 通知 µC。一旦音频被完全衰减，则禁止耳机与线路输出。一旦音频被完全衰减，耳机与线路输出在听不见的杂音情况下，可以在 50µs 内被禁止。输出被禁止后，将 MAX9850 置为关断状态。

立体声扬声器

MAX9850 可以与立体声扬声器放大器一起创建完整的扬声器放大方案。MAX9701，或其他 Maxim 立体声扬声器放大器可以用来驱动扬声器，而利用 MAX9850 集成的 DirectDrive 耳机放大器驱动耳机(见图 12)。

配置 GPIO，未连接耳机时输出高，连接耳机时输出低。连接 GPIO 至 MAX9701 的 $\overline{\text{SHDN}}$ 控制。配置中断使能寄存器，当 HPS 改变状态时，将 ALERT (寄存器 0x0, B7 位) 置位。µC 查询状态 A 寄存器并等待 HPS 改变状态时的 ALERT 置位。ALERT 置位时，µC 改变 GPIO 的状态，在耳机连接时关闭扬声器放大器，或在未连接耳机时使能扬声器放大器。

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

MAX9850

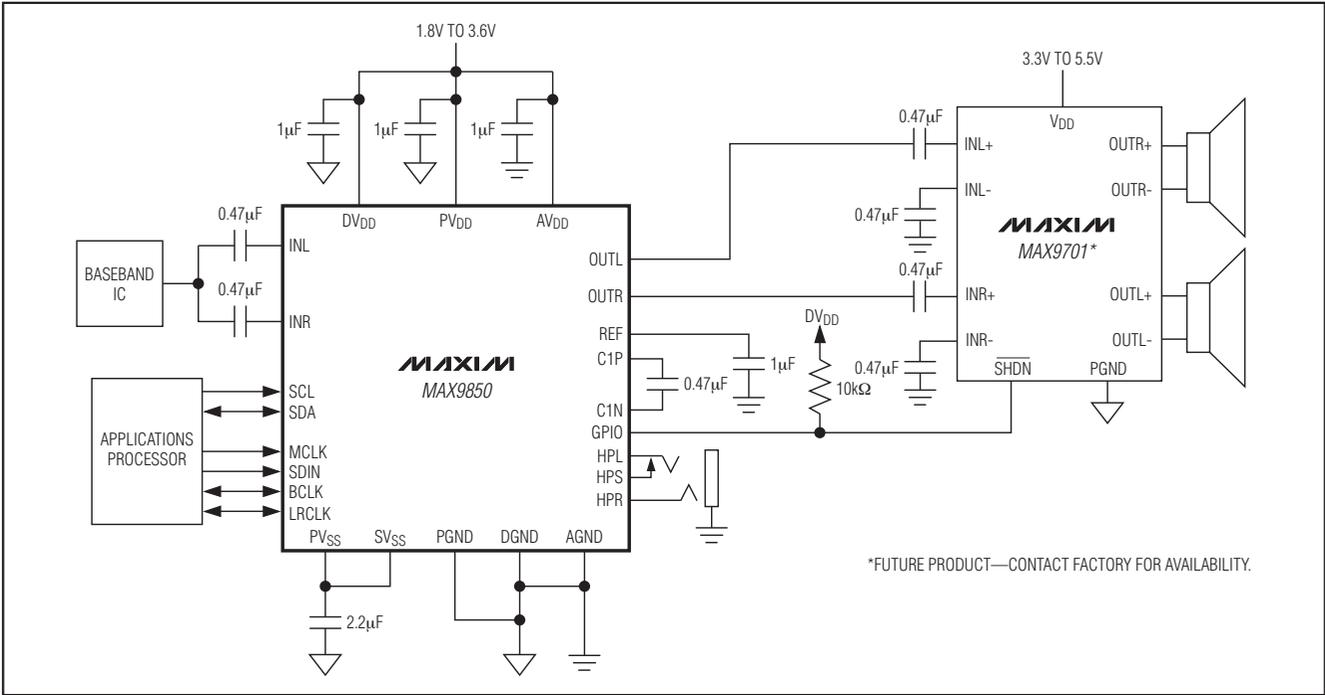


图 13. 蜂窝电话音频系统

蜂窝电话音频系统

MAX9850 是完整的蜂窝电话音频放大方案。在典型应用中，数字音频总线上的应用处理器可产生并输出铃声。连接基带 IC 至 MAX9850 线路输入，INR 和 INL。耳机放大器输出数字音频与线路输入的叠加信号(见图 13)。

耳机短路

在短路情况下，耳机放大器每声道电流将近 $\pm 300\text{mA}$ 。MAX9850 被设计为可以连续承受这样的电流。为了避免不必要的电池损耗，建议使能 IOHR 和 IOHL 硬件中断。 μC 可响应中断并关闭耳机放大器，然后等待一定延时周期。

只有右声道出现耳机短路情况时，还可能表示插入立体声插孔的是单声道耳机。于是 μC 可以通过将 MAX9850 置为单声模式，自动禁止右声道。这就区分了单声道插孔检测与短路条件。

印刷电路板布局与旁路

良好的印刷电路板布线是获得最佳性能的关键。在电源输入和放大器输出端使用宽的走线，以降低引线的寄生电阻引起的损耗，并改善器件的散热。良好的接地可以改善音频性能、减小通道间串扰，并防止数字开关噪声耦合到音频信号中。在印刷电路板上将 PGND、DGND 和 AGND 单点连接。将 DGND、PGND 及所有传输开关瞬态信号的引线避开 AGND 和模拟音频信号通道的布线或元件。

将与电荷泵有关的所有元件连接到 PGND。在器件上将 PV_{SS} 与 SV_{SS} 连接。将电荷泵电容尽可能靠近 PV_{SS} 摆放。确保 C2 连接到 PGND。用 1 μF 电容将 PV_{DD} 旁路到 PGND。将旁路电容尽可能靠近器件摆放。

MAX9850 的薄型 QFN 封装下方有裸露的散热焊盘。这个焊盘提供从管芯到印刷电路板的直接导热通道，用来降低封装的热阻。如果可能的话，将裸露的散热焊盘连接到电气绝缘的大面积铜焊盘上。若不能悬空，则将其连接到 AGND。

立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

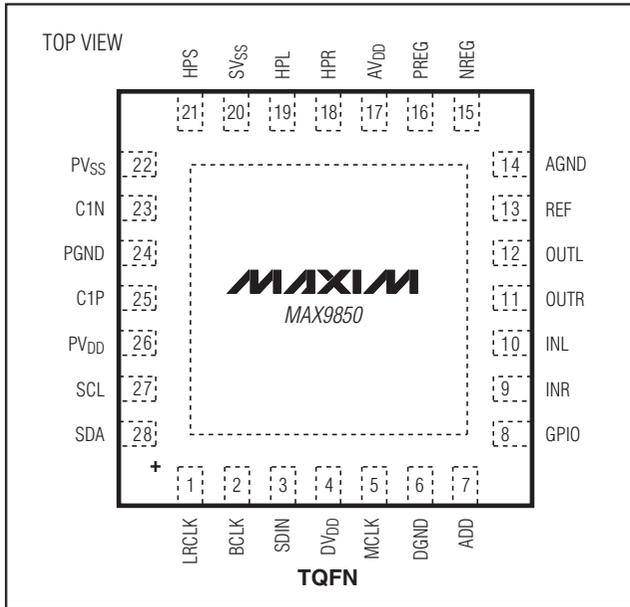
MAX9850

引脚配置

芯片信息

TRANSISTOR COUNT: 104,069

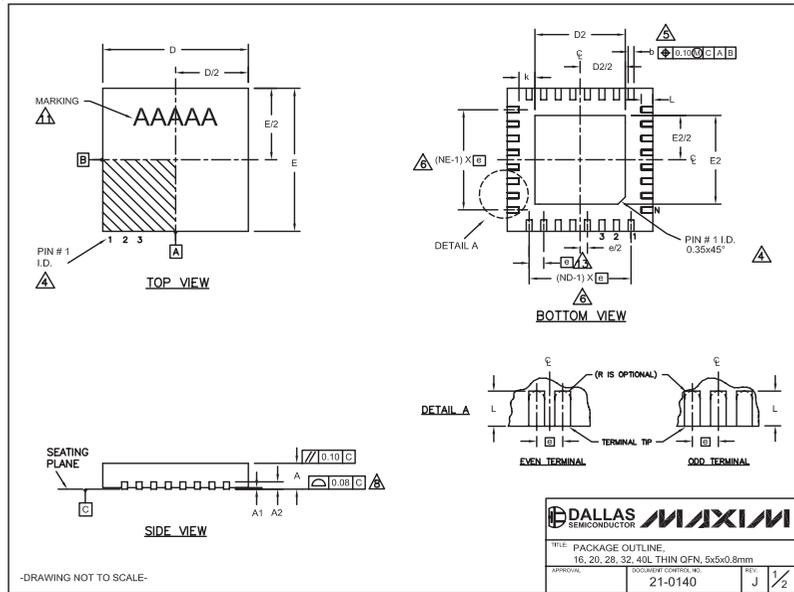
PROCESS: BiCMOS



立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器

封装信息

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格, 如需最近的封装外形信息, 请查询 www.maxim-ic.com.cn/packages。)



COMMON DIMENSIONS																
PKG	16L 5x5				20L 5x5				32L 5x5				40L 5x5			
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
A	0.70	0.75	0.80	0.70	0.75	0.80	0.70	0.75	0.80	0.70	0.75	0.80	0.70	0.75	0.80	
A1	0	0.02	0.05	0	0.02	0.05	0	0.02	0.05	0	0.02	0.05	0	0.02	0.05	
A2	0.20 REF.				0.20 REF.				0.20 REF.				0.20 REF.			
b	0.25	0.30	0.35	0.25	0.30	0.35	0.25	0.30	0.35	0.25	0.30	0.15	0.20	0.25		
D	4.90	5.00	5.10	4.90	5.00	5.10	4.90	5.00	5.10	4.90	5.00	5.10	4.90	5.00	5.10	
E	4.90	5.00	5.10	4.90	5.00	5.10	4.90	5.00	5.10	4.90	5.00	5.10	4.90	5.00	5.10	
e	0.80 BSC.				0.65 BSC.				0.50 BSC.				0.40 BSC.			
k	0.25	0.25			0.25			0.25			0.25			0.25		
L	0.30	0.40	0.50	0.45	0.55	0.65	0.45	0.55	0.65	0.30	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	
N	16	20	28	28	32	40										
ND	4	5	7	7	8	10										
NE	4	5	7	7	8	10										
JEDEC	WHFB		WHFC		WHHD-1		WHHD-2		----							

EXPOSED PAD VARIATIONS						
PKG CODES	D2			E2		
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
T1655-2	3.00	3.10	3.20	3.00	3.10	3.20
T1655-3	3.00	3.10	3.20	3.00	3.10	3.20
T1655N-1	3.00	3.10	3.20	3.00	3.10	3.20
T2055-3	3.00	3.10	3.20	3.00	3.10	3.20
T2055-4	3.00	3.10	3.20	3.00	3.10	3.20
T2055-5	3.15	3.25	3.35	3.15	3.25	3.35
T2855-3	3.15	3.25	3.35	3.15	3.25	3.35
T2855-4	2.60	2.70	2.80	2.60	2.70	2.80
T2855-5	2.60	2.70	2.80	2.60	2.70	2.80
T2855-6	3.15	3.25	3.35	3.15	3.25	3.35
T2855-7	2.60	2.70	2.80	2.60	2.70	2.80
T2855-8	3.15	3.25	3.35	3.15	3.25	3.35
T2855N-1	3.15	3.25	3.35	3.15	3.25	3.35
T3255-3	3.00	3.10	3.20	3.00	3.10	3.20
T3255-4	3.00	3.10	3.20	3.00	3.10	3.20
T3255-5	3.00	3.10	3.20	3.00	3.10	3.20
T3255N-1	3.00	3.10	3.20	3.00	3.10	3.20
T4055-1	3.40	3.50	3.60	3.40	3.50	3.60
T4055-2	3.40	3.50	3.60	3.40	3.50	3.60

**SEE COMMON DIMENSIONS TABLE

NOTES:

- DIMENSIONING & TOLERANCING CONFORM TO ASME Y14.5M-1994.
- ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. ANGLES ARE IN DEGREES.
- N IS THE TOTAL NUMBER OF TERMINALS.
- THE TERMINAL #1 IDENTIFIER AND TERMINAL NUMBERING CONVENTION SHALL CONFORM TO JEDEC 95-1 SPP-012. DETAILS OF TERMINAL #1 IDENTIFIER ARE OPTIONAL, BUT MUST BE LOCATED WITHIN THE ZONE INDICATED. THE TERMINAL #1 IDENTIFIER MAY BE EITHER A MOLD OR MARKED FEATURE.
- DIMENSION b APPLIES TO METALLIZED TERMINAL AND IS MEASURED BETWEEN 0.25 mm AND 0.30 mm FROM TERMINAL TIP.
- ND AND NE REFER TO THE NUMBER OF TERMINALS ON EACH D AND E SIDE RESPECTIVELY.
- DEPOPULATION IS POSSIBLE IN A SYMMETRICAL FASHION.
- COPLANARITY APPLIES TO THE EXPOSED HEAT SINK SLUG AS WELL AS THE TERMINALS.
- DRAWING CONFORMS TO JEDEC MO220, EXCEPT EXPOSED PAD DIMENSION FOR T2855-3 AND T2855-6.
- WARRPAGE SHALL NOT EXCEED 0.10 mm.
- MARKING IS FOR PACKAGE ORIENTATION REFERENCE ONLY.
- NUMBER OF LEADS SHOWN ARE FOR REFERENCE ONLY.
- LEAD CENTERLINES TO BE AT TRUE POSITION AS DEFINED BY BASIC DIMENSION "e", ±0.05.

-DRAWING NOT TO SCALE-

DALLAS SEMICONDUCTOR		MAXIM	
TITLE: PACKAGE OUTLINE			
16, 20, 28, 32, 40L THIN QFN, 5x5x0.8mm			
APPROVAL	DOCUMENT CONTROL NO.	REV.	1/2
	21-0140	J	

MAX9850 封装码: T2855-6

Maxim 不对 Maxim 产品以外的任何电路使用负责, 也不提供其专利许可。Maxim 保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。

36 **Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600**